

股票代號：6207



100 年 度

年 報

本年報查詢網址：公開資訊觀測站 <http://newmops.tse.com.tw>

證期局指定之資訊申報網址：<http://newmops.tse.com.tw>

本公司年報相關資料查詢網址：<http://www.lasertek.com.tw>

中 華 民 國 一 〇 一 年 六 月 十 九 日

#### 一、本公司發言人及代理發言人

發言人姓名：唐靜玲 職稱：協理  
電話：(07)8159877  
電子郵件信箱：lasertek@lasertek.com.tw  
代理發言人姓名：劉雅文 職稱：經理  
電話：(07)8159877  
電子郵件信箱：lasertek@lasertek.com.tw

#### 二、總公司及工廠之地址、電話

1. 總公司地址：高雄市前鎮區新生路 248-39 號  
電話：(07)815-9877
2. 分公司地址：高雄市鹽埕區七賢三路 209 號  
電話：(07)815-9877
3. 新竹分公司：新竹縣竹北市光明六路東二段 29 號 1 樓  
電話：(03)658-6579
4. 工廠地址：
  - (1) 臨廣一廠：高雄市前鎮區新生路 248-39 號  
電話：(07)815-9877
  - (2) 臨廣二廠：高雄市前鎮區新生路 248-12 號  
電話：(07)951-0828
  - (3) 臨廣三廠：高雄市前鎮區新生路 248-12 號 2 樓  
電話：(07)951-0828

#### 三、辦理股票過戶機構：

名稱：元大寶來證券股份有限公司  
地址：台北市大同區承德路三段 210 號 B1  
電話：(02)25865859  
網址：[www.yuanta.com.tw](http://www.yuanta.com.tw)

#### 四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址及電話：

會計師姓名：林億彰、王國華  
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所  
地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓  
電話：(02)2729-6666 網址：[www.pwc.com/tw](http://www.pwc.com/tw)

#### 五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

#### 六、公司網址：<http://www.lasertek.com.tw>

## 目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司簡介	6
參、公司治理報告	9
一、公司組織	9
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	11
三、公司治理運作情形	19
四、會計師公費資訊	27
五、更換會計師資訊	28
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年曾任職會計師事務所或其關係企業資訊	29
七、董事、監察人、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形	29
八、持股比例佔前十大股東間互為關係人資料	30
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	30
肆、募資情形	31
一、資本及股份	31
二、公司債辦理情形	37
三、特別股辦理情形	38
四、海外存託憑證辦理情形	38
五、員工認股權憑證辦理情形	38
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	38
七、資金運用計畫執行情形	50
伍、營運概況	52
一、業務內容	52
二、市場及產銷概況	63
三、從業員工資料	70
四、環保支出資訊	70
五、勞資關係	70
六、重要契約	71
陸、財務概況	72
一、最近五年度簡明財務資料	72
二、最近五年度財務分析	74
三、最近年度財務報告之監察人審查報告	76
四、最近年度財務報表	76
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表	76
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉事，應列明其對本公司財務狀況之影響	76

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項評估	77
一、財務狀況	77
二、經營結果	78
三、現金流量	79
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	79
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫	79
六、風險事項分析評估	80
七、其他重要事項	82
捌、特別記載事項	83
一、關係企業相關資料	83
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	86
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形	86
四、其他必要補充說明事項	86
玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	86

## 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

承蒙各位股東在百忙中仍撥冗參加雷科股份有限公司101年股東常會。本人謹代表公司及全體員工感謝各位對本公司的支持與愛護。

本公司於100年中創造歷史新高營收的營運成績，雖於下半年受歐債影響景氣下滑而致本公司營運未如預期，但本公司仍憑藉自身原有健全體質持續創造獲利，往後雷科全體同仁與經營團隊也會以更認真、嚴謹、積極的態度繼續努力，達到優異的經營成績。

茲將本公司100年度營運成果與101年度營業展望概要報告如下：

### 一、100年度營業報告：

#### （一）營業計劃實施成果及概況

本公司100年度集團合併營業收入2,519,491千元，較99年度合併營業收入2,493,512千元，增加25,979千元，合併營收增加1.04%，100年度國內營業收入1,254,945千元，較99年度國內營業收入1,143,523千元，增加111,422千元，營收增加9.74%。100年度稅後淨利209,190千元，較99年度稅後淨利292,990千元，減少83,800千元，淨利減少28.6%。

#### （二）營業收支預算預算執行情形

本公司100年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

年 度		100 年度 (集團合併)	99 年度 (集團合併)	100 年度 (母公司)	99 年度 (母公司)
財 務 收 支	項 目				
	營業收入淨額	2,519,491	2,493,512	1,254,945	1,143,523
	營業毛利	486,513	535,216	258,671	232,938
獲 利 能 力	稅後損益	209,350	292,693	209,190	292,990
	資產報酬率(%)	7.18	10.82	7.94	14.74
	股東權益報酬率(%)	16.22	23.27	16.22	20.72
	營業利益佔實收資本比率 (%)	17.46	30.59	11.72	7.36
	稅前純益佔實收資本比率 (%)	26.11	34.66	26.09	30.31
	純益率	8.31	11.74	16.67	30.32
	每股盈餘(元)	2.60	3.91	2.60	3.92

(四) 研究發展狀況

1. 最近年度研發計畫

100 年度投入研發之技術與產品：

年度	研發成果
100年度	因中、大型尺寸陶瓷基板被廣泛運用於LED 載板、高頻元件，但普遍都存在散熱不良問題，故於製程中都以鑽孔方式作為改善對策，驗證結果也確實有效解決散熱不良問題，目前已研發成功IR雷射陶瓷鑽孔機並量產。
100年度	整流二極體晶圓雷射切割機已完成並提供客戶投產。
100年度	高速Wafer Marking 一直是美國GSI 設備為主，目前已經研發全自動Wafer Marking，並提供客戶投產。
100年度	二代橋式FPC 軟性PCB 之外型雷射切割機—已完成整機測試並提供客戶投產。
100年度	SMT STENCIL 銅板切割機由原本單軸架構改為龍門機型，可有效提升切割速率，已完成整機測試並提供客戶投產。
100年度	現今的BGA 返修製程仍然必須仰賴人工操作，損耗龐大的人力資源，藉此研發雷射除膠機，取代人工除膠製程，減少人力資源的浪費並提升產能速度，目前已研發成功並提供客戶投產。

2. 最近兩年度研究發展支出

單位：新台幣仟元

年度	100 年度	99 年度
研究發展費用	17,156	27,500

## 二、101 年度營業計劃與未來發展策略

### (一)經營方針

#### 1. 持續擴大各產品線銷售：

本公司一向以客戶需求為發展中心，希望能提供客戶更完整的產品。本公司在 SMD 捲裝材料產品類別內，同時提供被動元件產業、半導體及 LED 等產業所需求之元件捲裝材料，提供適合各項元件之不同需求。本公司銷售製造產品除 SMD 捲裝材料外，另一大類則為設備產品，在銷售代理 SMT 設備產品方面，本公司將持續擴增開發更多代理設備，以提供客戶全產品服務。在雷射設備產品方面，本公司持續研發製造各類應用之雷射機台，以滿足客戶的不同需求。

#### 2. 持續研發鐳射機器設備應用

鐳射機器應用已在台灣廠及新加坡廠同時以 Laser Tek 做為研究發展、生產製造、行銷的領導品牌，目前已具成效。100 年已研發完成 IR 雷射陶瓷基板鑽孔機、整流二極體晶圓雷射切割機以及龍門型 SMT STENCIL 鋼板切割機等設備，預計 101 年除持續研發改良提高原有機型良率與技術外，也將同時進行多項雷射機型研發，並推出相關雷射機台。

#### 3. 開發與整合能源事業：

順應全球提倡節能減碳需求，除在電子產業努力耕耘外，本公司也因應市場需求，掌握最佳契機，並發揮本公司通路銷售優勢，開始積極開發 LED 燈具及節能空調銷售市場，期盼能推廣節能減碳的生活，為環境盡一份心力，也為本公司開拓更多元化的營運市場。

### (二)預期銷售數量及其依據

銷售數量係依據市場需求狀況與發展趨勢、客戶營運概況及本公司目前接單情形，並參酌本公司之產能規模而訂定。綜觀目前各國經濟指標、全球經濟危機陷入衰退時代，受此情況影響，本公司秉持專業、誠信、共享、創新的經營理念，積極因應局勢變化，掌握市場脈動以達成 2012 年營運目標。

### (三)重要產銷政策

#### 1. 生產政策：

##### (A)SMD 捲裝材料：

持續改善並提升產品品質與產能、開發較低成本原材，以降低生產製造成本。

(B)鐳射機器設備：

持續研發各式應用雷射設備機，更新新型技術，與設備供應商建立更緊密的策略聯盟關係。

2. 銷售政策：

- (A)持續鞏固原有被動元件、SMT、半導體與 LED 產業客戶外，鎖定主流市場，開發高品質具競爭性產品。
- (B)加強台灣與海外即時發貨服務與在地服務，並持續推動全球分工集團中心制，即時配合客戶大量生產需求。
- (C)深植人力培育計畫，以佈局全球行銷為目標，強化公司人力資源，提高產品質量管控與客戶售後服務，成功建構全球供應能力與效益。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- (一)就外部競爭環境而言，產業競爭是必然且維持成長之良性互動，本公司仍持續研發新產品、改善品質以強化自身的優勢，提高競爭力已達成客戶需求。
- (二)最近幾年國內外重要政策及法律變動對本公司財務、業務無重大影響，未來亦隨時取得相關資訊，並即時研擬必要因應措施，以符合公司營運需要。
- (三)整體經營環境日益複雜，公司評估未來經營方向及重大決策時，參考全球總體經濟及公司現狀，審慎評估最佳策略。

儘管全球經濟已逐漸復甦，雷科持續以更加務實的行動方案來面對各種不同的挑戰與詭譎多變的環境，在 SMD 材料供應方面，確實去掌握下游產業的產能擴充，確保客戶 JIT 供應無虞，並持續改善提升產品品質，提升利潤與服務客戶。在機械設備製造方面，將更積極投入發展鐳射在 SMT 相關應用的普及化，提昇設備的功能與市佔率，以及擴展 SMT 線上設備銷售市場。

展望未來我們持續以更積極兼具穩健的步伐爭取更高的營運績效，期盼各位股東先進仍然一秉初衷，繼續給予「Laser Tek」集團企業支持與鼓勵。

謝謝大家，最後敬祝諸位股東女士、先生：

身體健康 心想事成

董事長：鄭再興



## 貳、公司簡介

一、設立登記日期：民國七十七年九月六日

### 二、公司沿革

#### 1. 雷科願景：成為全球第一的 SMT 解決方案供應商（Global Top 1 SMT Supply Chain Total Solution Provider）。

民國七十七年	九 月	成立雷科股份有限公司，資本額新台幣伍佰萬元。
民國八十二年		1992 年榮獲美商 CYBER OPTICS 全球銷售冠軍獎。
民國八十二年	一 月	成立精密陶瓷雷射切割新銜廠。
民國八十四年		1995 年榮獲日商光洋林博公司全球銷售最優獎。
民國八十五年	一 月	新銜廠增加精密陶瓷基板雷射切割第二條生產線。
	五 月	現金增資肆佰萬元，資本額增為新台幣玖佰萬元。
民國八十七年	十二月	現金增資貳仟壹佰萬元，資本額增為新台幣參仟萬元。
民國八十七年		1998 年榮獲美商 CYBER OPTICS 全球銷售冠軍獎。
民國八十八年	十 月	現金增資貳仟萬元，資本額增為新台幣伍仟萬元。
民國八十八年		1999 年榮獲 PHILIPS 公司績優廠商獎。
民國八十八年	十二月	成立楠梓分公司，開始從事表面黏著元件封裝紙帶之分條及打孔業務。
民國八十九年	十 月	新銜廠增加二條精密陶瓷基板雷射切割生產線。
民國八十九年	十二月	現金增資陸仟貳佰伍拾萬元，資本額增為新台幣壹億壹仟貳佰伍拾萬元。
民國八十九年		2000 年榮獲美商 CYBER OPTICS 全球銷售冠軍獎。
民國九十年	一 月	於臨廣加工區設立雷科總公司，分條及打孔廠設立。
民國九十年	五 月	現金增資捌仟萬元，盈餘轉增資壹仟玖佰陸拾柒萬元，資本額增為貳億壹仟貳佰壹拾柒萬元。
民國九十一年	一 月	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心興櫃股票掛牌(雷科 R045)。
民國九十一年	一 月	2001 年榮獲美商 CYBER OPTICS 全球銷售冠軍獎。
民國九十一年	一 月	雷科東莞廠設立。
民國九十一年	三 月	購置臨廣加工出口區新廠房(二廠)
民國九十一年	六 月	通過 ISO-9001 2000 年版認證。
民國九十一年	六 月	現金增資伍仟萬元，盈餘轉增資肆仟貳佰參拾壹萬貳仟元，資本額增為參億肆佰肆拾捌萬貳仟元。
民國九十一年	七 月	雷科電子材料昆山有限公司成立。
民國九十一年	十 月	天下雜誌「2002 年台灣中小企業潛力一百強調查」，獲選成長最快第二名。

民國九十一年	十二月	通過財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心股票上櫃掛牌交易。
民國九十二年	一 月	上海普雷貿易公司設立及臨廣三廠設立, 正式開始運作。
民國九十二年	四 月	董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債新台幣貳億元。
民國九十二年	六 月	轉投資設立 LASER TEK(SINGAPORE)PTE. LTD.
民國九十二年	七 月	盈餘轉增資柒仟肆佰參拾玖萬陸仟肆佰元, 資本額增為參億柒仟捌佰捌拾柒萬捌仟肆佰元。
民國九十二年	七 月	榮獲第六屆國家小巨人獎。
民國九十二年	八 月	鄭董事長榮獲傑出企業領導人金峰獎。
民國九十二年	十二月	鄭再興董事長與 2002 年諾貝爾經濟獎得主弗南、史密斯博士 (Dr. Vernon L. Smith) 討論「全球化與台灣經濟發展」。
民國九十二年	十二月	鄭再興董事長擔任第 13 屆國際比較管理學術會議全球化的挑戰與轉型科技組主持人。
民國九十三年	一 月	2003 年榮獲美商 CYBER OPTICS USA 全球行銷首獎。
民國九十三年	一 月	獲選上市櫃公司一千大企業。
民國九十三年	一 月	雷科廈門廠設立, 正式開始運作。
民國九十三年	四 月	發行國內第二次有擔保轉換公司債參億陸仟萬元。
民國九十三年	九 月	鄭再興董事長榮獲傑出企業經理人獎。
民國九十三年	十 月	鄭再興董事長榮獲中華民國第 27 屆青年創業楷模。
民國九十三年	十 月	獲頒 2004 年中小企業組織學習獎。
民國九十三年	十一月	經濟部核發「雷科全球企業營運總部」證明函。
民國九十四年	一 月	雷科榮獲惠普(Hewlett-Packard Development Company)第二屆金銷獎。
民國九十四年	一 月	雷科榮獲美商 CYBER OPTICS MAKING LIGHT WORK #1WORLDWIDE SE-300 SALES 2004。
民國九十四年	一 月	雷科榮獲 Deloitte Technology Fast 500Asia Pacific 亞太地區高科技高成長 500 強企業。
民國九十四年	七 月	轉投資設立 LAMDA GROUP L. L. C. (U. S. A.)
民國九十四年	十二月	雷科獲教育部頒發提供身心障礙學生校外實習及就業愛心模範廠商。
民國九十五年	一 月	雷科榮獲美商 CYBER OPTICS 2005 TOP ASIA SALES。
民國九十五年	一 月	雷科泰普獨資廠設立。
民國九十五年	十 月	東莞國創晶片測包廠設立
民國九十五年	十一月	雷科獲經濟部頒發國家金楷獎。
民國九十六年	一 月	雷科榮獲美商 CYBER OPTICS 2006 TOP ASIA SALES。
民國九十六年	十二月	申請經濟部產業技術計劃『奈秒雷射微製程設備技術整合計劃』獲得核准通過。
民國九十七年	一 月	雷科榮獲美商 CYBER OPTICS 2007 TOP ASIA SALES。
民國九十七年	五 月	天下雜誌「2007 年 1000 大製造業調查」, 排名第 825 名, 電子業第 89 名。
民國九十七年	十 月	榮獲第十七屆國家磐石獎。

民國九十七年	十 二 月	通過第四屆公司治理制度評量認證。
民國九十八年	三 月	雷科股份有限公司 LED 照明產品部門成立。
民國九十八年	五 月	雷科股份有限公司成立 ECT 包裝材料部門，跨入半導體主動元件封裝材料市場。
民國九十八年	九 月	雷科股份有限公司成立冷氣空調部門，與 IS/LED/冷氣空調部門合併為能源事業部。
民國九十八年	十 月	雷科股份有限公司榮獲行政院勞委會頒發「品質規範評核金牌」企業機構版。
民國九十九年	二 月	雷科股份有限公司成立新竹分公司，成立「半導體 SEMI 事業群」及「科技材料事業群」。
民國九十九年	三 月	雷科新竹分公司成立「光電設備事業群」。
民國九十九年	三 月	雷科股份有限公司通過第五屆公司治理制度評量認證。
民國九十九年	七 月	發行國內第三次無擔保轉換公司債新台幣五億元
民國九十九年	十 月	轉投資節研節能科技股份有限公司、威克半導體股份有限公司。
	十 月	間接轉投資雷育電子塑膠（蘇州）有限公司。
民國九十九年	十 二 月	獲頒第十屆「文馨獎」銅獎。
民國一〇〇年	一 月	間接轉投資 JIANWEITE INTERNATIONAL CO.,LTD.、FU WAH COMPANY LIMITED 及深圳市富威強實業有限公司。
民國一〇〇年	五 月	發行國內第四次無擔保轉換公司債新台幣陸億元。
民國一〇一年	五 月	天下雜誌「2011 年 1000 大製造業」排名第 845 名，電子業排名為第 84 名。

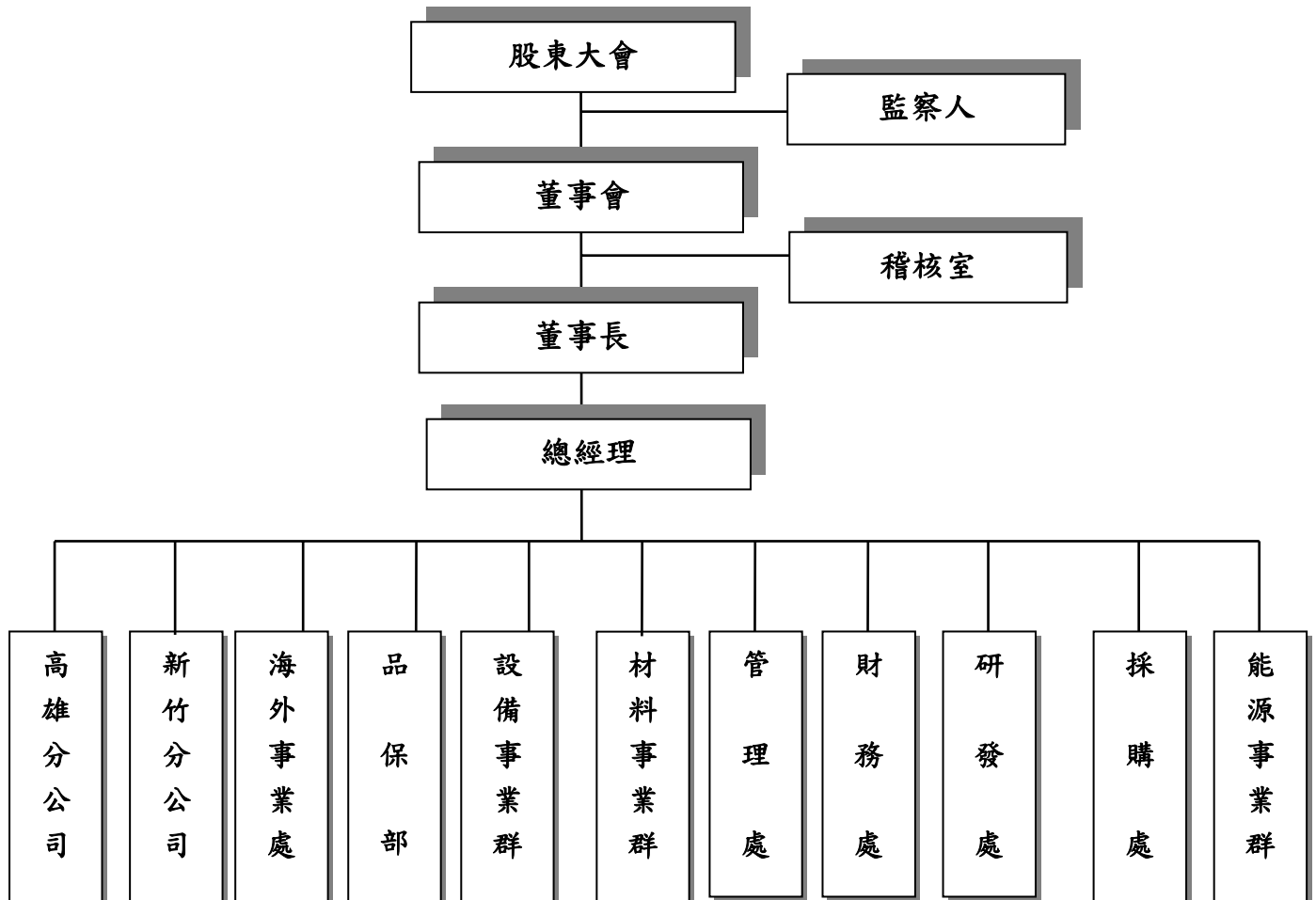
2. 最近年度及截至年報刊印日止辦理公司併購之情形：無。
3. 最近年度及截至年報刊印日止董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換情形：無。
4. 最近年度及截至年報刊印日止經營權之改變、經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響：無。

## 參、公司治理報告

### 一、公司組織

#### (一)組織系統

##### 1. 組織結構：



## 2. 各主要部門所營業務

部門名稱	工 作 職 掌
稽 核 室	執行內部稽核、內部控制規劃、預算績效評估並提供制度改善與建議。
管 理 處	負責有關國內外採購、人力資源、關務、文書、總務、工安環保、財產。 管理、MIS 資訊管理、公關等事項。
財 務 處	負責擬制、建立及執行有關財務管理、會計管理、股務管理、租稅規劃、資金運用、預算財測等業務。
採 購 處	負責各部門採購作業、供應商往來與評估、交期跟催等。
品 保 部	負責產品來料檢驗IQC 過程檢驗PQC 出廠檢驗OQC 首件檢驗FQC研發處 掌理產品研發送樣、品質管制、儀器模具校正、機器開發、相關產品研發等。
研 發 處	負責新設備開發、相關產品研發改良，品質管控、儀器模具校正等業務。
海 外 事 業 群	負責公司海外投資設廠、評估與管理、研發、製造、銷售、財會等業務。
材 料 事 業 群	負責SMD主被動元件包材相關事業之國內外營業產銷企劃、市場研究、行銷策略擬訂、宣傳廣告、市場開拓、出口業務、客戶信用調查及帳款催收、售後服務等。
設 備 事 業 群	負責鐳射設備及SMT 設備等相關事業之國內外營業產銷企劃、市場研究、行銷策略擬訂、宣傳廣告、市場開拓、出口業務、客戶信用調查及帳款催收、售後服務、產品加工製造等。
能 源 事 業 群	負責相關能源產品之國內外營業產銷企劃、市場研究、行銷策略擬訂、宣傳廣告、市場開拓、出口業務、客戶信用調查及帳款催收、售後服務等。
新 竹 分 公 司	負責半導體、光電等產品之國內外營業產銷企劃、市場研究、行銷策略擬訂、宣傳廣告、市場開拓、出口業務、客戶信用調查及帳款催收、售後服務，以及其他部門在新竹區銷售之售後服務等。
高 雄 分 公 司	負責加工區外銷售、出口業務與業務開拓。

## 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理及分支機構主管資料

### (一) 董事及監察人之姓名、學(經)歷、持有股份及性質

101年4月20日

職稱	姓名	選任日期	初次選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股份(註)		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
					股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係
法人董事	普雷氏投資(股)公司	99.06.04	90.07.14	三年	5,103,541	7.13	5,901,038	7.63	0	0	0	0	—	—	—	—	—
董事長	普雷氏投資(股)公司 代表人：鄭再興	99.06.04	90.07.14	三年	159,035	0.22	233,501	0.30	325,721	0.42	0	0	飛利浦建元電子設備 經理 中山大學管理研究所	普雷氏投資(股)公司董事 長 順治投資(股)公司監察人	監察人	鄭玉慧	姊弟
法人董事	順治投資(股)公司	99.06.04	90.07.14	三年	554,384	0.77	641,013	0.83	0	0	0	0	—	—	—	—	—
董 事	順治投資(股)公司 代表人：莊凱婷	99.06.04	90.07.14	三年	0	0	110,120	0.14	0	0	0	0	東海大學社會系	無	無	無	無
董 事	傅新喬	99.06.04	90.07.14	三年	218,768	0.31	252,953	0.33	723,416	0.93	0	0	中山科學院技士、中山大學管研所	逢達興企業有限公司董事	無	無	無
董 事	黃萌義	99.06.04	99.06.04	三年	301,019	0.42	317,030	0.41	52,630	0.07	0	0	飛利浦建元電子生產設備 經理 中山大學管理研究所	本公司設備總經理	無	無	無
獨立董 事	劉德明	99.06.04	93.04.29	三年	0	0	0	0	0	0	0	0	俄亥俄州立大學財務經濟 博士、中山大學財管系 教授	無	無	無	無
獨立董 事	黃來福	99.06.04	96.06.13	三年	23,000	0.03	26,594	0.03	0	0	0	0	中山開發投資(股)負責人 中山大學管理研究所	中山開發投資(股)負責人	無	無	無
監察人	鄭玉慧	99.06.04	90.07.14	三年	132,744	0.19	153,486	0.20	0	0	0	0	實踐大學會計系	威克半導體(股)監察人	董事長	鄭再興	姊弟
監察人	陳志祥	99.06.04	90.07.14	三年	625,855	0.87	723,652	0.94	14,813	0.02	0	0	祥達科技有限公司董事長 中山大學管理研究所	祥達科技有限公司負責人	無	無	無
監察人	徐守德	99.06.04	91.04.09	三年	0	0	0	0	0	0	0	0	德明財經科技大學校長、 中山大學學務長 美國阿拉巴馬大學財管博 士	華立企業(股)獨立監察人 鑫科材料科技(股)監察人 智冠科技(股)獨立董事	無	無	無

## 2. 董事及監察人所具專業知識及獨立性情形：

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格	符合獨立性情形（註1）										兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數		
		商務、法務、財 務、會計或公司 業務所須相關 科系之公私立 大專院校講師 以上	法官、檢察官、律 師、會計師或其他 與公司業務所需 之國家考試及格 領有證書之專門 職業及技術人員	商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
普雷氏投資 (股)公司 代表人： 鄭再興			✓		✓				✓	✓			✓		0
順治投資(股) 公司 代表人： 莊凱婷				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
傅新喬			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
吳袖田(註2)				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
黃萌義					✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	0
劉德明	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
黃來福			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
鄭玉慧			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	0
陳志祥	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
徐守德	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1

註1：各董事、監察人符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第30條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

註2：已於100年4月18日辭任。

## 3. 董事或監察人屬法人股東者，該法人股東之主要股東：

- (1) 法人股東股權比例達百分之十以上或股權比例占前十名股東名稱及其持股比例：

99年4月5日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
普雷氏投資(股)公司	鄭再興(88%)

註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

- (2) 主要股東為法人者，其主要股東名稱及其持股比例：無

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門與分支機構主管資料：

101 年 5 月 29 日

職稱	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形
			股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
總經理	林昭雄	96.05.02	33,081	0.04	0	0	0	0	協禧電機(股)公司總經理 成功大學工業管理研究所	無	無	無	無	無
總經理	黃萌義	94.07.01	317,030	0.41	52,630	0.07	0	0	飛利浦建元電子生產設備經理 中山大學管理研究所	無	無	無	無	
副總經理	熊學毅	100.04.01	233,896	0.30	25,852	0.03	0	0	楠梓電子(股)公司工程師 高雄第一科技大學行銷所	無	無	無	無	
業務協理	楊穎	96.09.14	5,748	0.01	0	0	0	0	台灣黑田電器(股)公司 副理 中山大學管理研究所	無	無	無	無	
生產處長	吳文吉	98.04.16	10,000	0.01	0	0	0	0	鈦昇(股)公司生產部經理 中原大學機械工程學系	無	無	無	無	
財務主管	唐靜玲	96.03.01	3,163	0.02	0	0	0	0	安侯建業聯合會計師事務所查帳員 成功大學會計學系	無	無	無	無	
稽核主管	陳炫佑	100.11.29	0	0	0	0	0	0	中日新科技(股)公司稽核主管 逢甲大學會計系	無	無	無	無	



(三) 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1. 董事（含獨立董事）之酬金

單位：新台幣仟元

職 稱	姓 名	董事酬金								A、B、C及D 等四項總額占稅 後純益之比例 (註 11)		兼任員工領取相關酬金										A、B、C、D、 E、F及G等七 項總額占稅後 純益之比例(註 11)		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 (註 12)		
		報酬(A) (註 2)		退職退休金(B)		盈餘分配之酬勞 (C)(註 2)		業務執行費 用(D)(註 4)				薪資、獎金及特 等(E)(註 5)		退職退休金(F)		盈餘分配員工紅利(G)(註 6)				員工認股權憑 證得認購股數 (H)(註 7)						
		本 公 司	合 併 報 表 內 所 有 公 司 (註 8)	本 公 司	合 併 報 表 內 所 有 公 司 (註 8)	本 公 司	合 併 報 表 內 所 有 公 司 (註 8)	本 公 司	合 併 報 表 內 所 有 公 司 (註 8)	本 公 司	合 併 報 表 內 所 有 公 司 (註 8)	本 公 司	合 併 報 表 內 所 有 公 司 (註 8)	本 公 司	合 併 報 表 內 所 有 公 司 (註 8)	本公司		合併報表內所 有公司 (註 8)		本 公 司	合 併 報 表 內 所 有 公 司 (註 8)	本 公 司	合 併 報 表 內 所 有 公 司 (註 8)			
董事	普雷氏投資 (股)公司	0	0	0	0	1,422	1,422	0	0	0.68%	0.68%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.68%	0.68%	無
董事長	鄭再興	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835	6,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.88%	3.22%	無
董事	順 治 投 資 (股)公司	0	0	0	0	250	250	0	0	0.12%	0.12%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.12%	0.12%	無
董事代表	莊凱婷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無
董事	黃萌義	0	0	0	0	200	200	0	0	0.1%	0.1%	3,173	4,039	55	55	1,050	0	1,050	0	0	0	0	0	1.61%	2.55%	無
董事	傅新喬	0	0	0	0	200	200	0	0	0.1%	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1%	0.1%	無
董事	吳袖田(註 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無
獨立董事	劉德明	0	0	0	0	200	200	0	0	0.1%	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1%	0.1%	無
獨立董事	黃來福	0	0	0	0	200	200	0	0	0.1%	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1%	0.1%	無

註 1：於 100 年 4 月 18 日解任。

註 2：100 度盈餘分配議案經董事會通過，尚未經股東會決議。

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
低於 2,000,000 元	普雷氏投資、順治投資、傅新喬、劉德明、黃來福、黃萌義、鄭再興、莊凱婷、吳袖田	普雷氏投資、順治投資、傅新喬、劉德明、黃來福、黃萌義、鄭再興、莊凱婷、吳袖田	普雷氏投資、順治投資、傅新喬、劉德明、黃來福、莊凱婷、吳袖田	普雷氏投資、順治投資、傅新喬、劉德明、黃來福、莊凱婷、吳袖田
2,000,000 元（含）～ 5,000,000 元	—	—	黃萌義、鄭再興	黃萌義
5,000,000 元（含）～ 10,000,000 元	—	—	—	鄭再興
10,000,000 元（含）～ 15,000,000 元	—	—	—	—
15,000,000 元（含）～ 30,000,000 元	—	—	—	—
30,000,000 元（含）～ 50,000,000 元	—	—	—	—
50,000,000 元（含）～ 100,000,000 元	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	9 人	9 人	9 人	9 人

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。

註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。

註 7：係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。

註 8：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 9：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 11：稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註 12：a. 本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。

b. 若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 及 J 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

\* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

## 2. 監察人之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	監察人酬金								A、B、C及D等四項總額 占稅後純益之比例		有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		盈餘分配之酬勞(C)（註）		業務執行費用(D)				
		本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	
監察人	鄭玉慧	0	0	0	0	416	416	0	0	0.20%	0.20%	無
監察人	陳志祥											
監察人	徐守德											

註：經董事會擬議通過，尚未經股東會決議通過。

### 酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司	合併報表內所有公司
	鄭玉慧、陳志祥、徐守德	鄭玉慧、陳志祥、徐守德
低於 2,000,000 元	—	—
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元	—	—
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元	—	—
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元	—	—
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	3 人	3 人

註 1：監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。

註 4：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 7：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註 9：a. 本欄應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。

b. 若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司監察人於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

\* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

### 3. 總經理及副總經理之報酬

100 年度/單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及 特支費等(C)		盈餘分配之員工紅利金額 (D)(註4)				A、B及C等三項總額占稅後 純益之比例(%) (註4)		取得員工認股權 憑證股數		有 無 自 以 資 酬 有 來 司 投
		本公司	合併報表內 所有公司	本公司	合併報表內 所有公司	本公司	合併報表內 所有公司	本公司		合併報表內 所有公司		本公司	合併報表內所有 公司	本公司	合併報表內 所有公司	
								現金紅利 金額	股票 紅利 金額	現金紅利 金額	股票 紅利 金額					
總經理	林昭雄	4,274	7,270	110	110	3,296	3,296	2,300	0	2,300	0	4.77%	6.20%	0	0	無
總經理	李雨龍(註1)															
設備總經理	黃萌義															
副總經理	熊學毅															
副總經理	張志賓(註2)															
副總經理	劉滄雅(註3)															

註1：於100年6月30日離職。

註2：於100年5月13日離職。

註3：於100年11月10日離職。

註4：100度盈餘分配議案經董事會通過，尚未經股東會決議。

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	合併報表內所有公司
低於2,000,000元	李雨龍、劉滄雅、張志賓	李雨龍、劉滄雅、張志賓
2,000,000元(含)～5,000,000元	林昭雄、黃萌義、熊學毅	林昭雄、黃萌義、熊學毅
5,000,000元(含)～10,000,000元	—	—
10,000,000元(含)～15,000,000元	—	—
15,000,000元(含)～30,000,000元	—	—
30,000,000元(含)～50,000,000元	—	—
50,000,000元(含)～100,000,000元	—	—
100,000,000元以上	—	—
總計	6人	6人

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)或(1-2)。

註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利)，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。

註5：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。

註6：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註8：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註9：稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註10：a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。

b. 若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所擔任身分分別所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

\*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

#### 4. 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

單位：新台幣仟元、仟股

職稱		姓名	股票紅利 金額	現金紅利 金額(註1)	總計	總額占稅後 純益之比例 (%)
經 理 人	總經理	林昭雄	0	2,000	2,000	0.96%
	副總經理	黃萌義				
	副總經理	熊學毅				
	財務主管	唐靜玲				

註1：100度盈餘分配議案經董事會通過，尚未經股東會決議。

\*係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利)，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。

註2：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。

註3：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。

##### 1. 酬金總額占稅後純益比例之分析：

項	酬金總額占 稅後純益比例(%)		差異分析
	100年度	99年度	
董事	1.18%	2.74%	99~100年度董監、總經理及副總經理酬勞金額占該年度稅後純益比重分別為0.41%~2.74%及0.20%~3.81%，差異不大。
監察人	0.20%	0.41%	
總經理、 副總經理	3.81%	2.05%	

註：100度盈餘分配議案經董事會通過，尚未經股東會決議。

##### 2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司給付酬金均依照且符合本公司章程所定標準，並依據各董事、監察人、總經理及副總經理對公司的貢獻、對經營績效的影響給付。

### 三、公司治理運作情形

#### (一) 董事會運作情形：

最近年度(100)董事會開會 A：9 次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數 B	委託出席 次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註2)	備註
董事長	普雷氏投資(股)公司 代表人：鄭再興	9	0	100%	
董事	順治投資(股)公司 代表人：莊凱婷	7	0	78%	
董事	傅新喬	8	0	89%	
董事	吳袖田(註1)	1	0	50%	
董事	黃萌義	8	0	89%	
獨立董事	劉德明	7	0	78%	
獨立董事	黃來福	9	0	100%	

註1：於100年4月18日辭任。

註2：實際出(列)席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

其他應記載事項：

- 一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無獨立董事反對或保留意見之情事。
- 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無與董事有利害關係之議案。
- 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：董事會職能持續加強。

註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：

- (1) 年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

(1) 本公司目前尚未設立審計委員會。

(2) 監察人參與董事會出席狀況如下：

最近年度董事會開會 9 次 (A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	實際列席率(%) (B / A)	備 註
監察人	鄭玉慧	9	100%	
監察人	陳志祥	9	100%	
獨立監察人	徐守德	6	67%	
其他應記載事項：				
一、監察人之組成及職責：				
(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形 (例如溝通管道、方式等)：監察人認為有必要時得與員工及股東直接聯絡。				
(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 (例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等)：內部稽核人員及會計師對於公司內部控制執行情形及內部稽核結果定期向監察人報告。				
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事 會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。				

註：

- \* 年度終了日前有監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。
- \* 年度終了日前，有監察人改選者，應將新、舊任監察人均予以填列，並於備註欄註明該監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
<p>一、公司股權結構及股東權益</p> <p>(一) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式</p> <p>(二) 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形</p> <p>(三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式</p>	<p>本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜。</p> <p>本公司隨時掌握實際控制公司之主要股東名單，且與主要股東關係良好。</p> <p>本公司與關係企業公司間之財務、業務相關作業辦法，已訂定具體書面制度並據以執行。</p>	<p>無</p> <p>無</p> <p>無</p>
<p>二、董事會結構及獨立性</p> <p>(一) 公司設置獨立董事之情形</p> <p>(二) 定期評估簽證會計師獨立之情形</p>	<p>本公司業已設置二席獨立董事。</p> <p>本公司董事會定期評估簽證會計師之獨立情形。</p>	<p>無</p> <p>無</p>
<p>三、建立與利害關係人溝通管道之情形</p>	<p>本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜。</p>	<p>無</p>
<p>四、資訊公開</p> <p>(一) 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形</p> <p>(二) 公司採取其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)</p>	<p>本公司已架設網站，定期揭露相關資訊。</p> <p>本公司設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作，並已依規定建立發言人制度。</p>	<p>無</p> <p>無</p>
<p>五、公司設置提名或薪酬委員會等功能委員會之運作情形</p>	<p>本公司已設置薪酬委員會，目前運作情形良好。</p>	<p>其他各類功能性委員會，本公司未來將視實際需要設置之。</p>
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：本公司尚未訂定公司治理實務守則，但公司之運作皆依公司治理實務守則處理。</p>		



項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因												
<p>一、公司股權結構及股東權益</p> <p>(一) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式</p> <p>(二) 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形</p> <p>(三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式</p>	<p>本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜。</p> <p>本公司隨時掌握實際控制公司之主要股東名單，且與主要股東關係良好。</p> <p>本公司與關係企業公司間之財務、業務相關作業辦法，已訂定具體書面制度並據以執行。</p>	<p>無</p> <p>無</p> <p>無</p>												
<p>二、董事會結構及獨立性</p> <p>(一) 公司設置獨立董事之情形</p> <p>(二) 定期評估簽證會計師獨立之情形</p>	<p>本公司業已設置二席獨立董事。</p> <p>本公司董事會定期評估簽證會計師之獨立情形。</p>	<p>無</p> <p>無</p>												
<p>三、建立與利害關係人溝通管道之情形</p>	<p>本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜。</p>	<p>無</p>												
<p>四、資訊公開</p> <p>(一) 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形</p> <p>(二) 公司採取其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)</p>	<p>本公司已架設網站，定期揭露相關資訊。</p> <p>本公司設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作，並已依規定建立發言人制度。</p>	<p>無</p> <p>無</p>												
<p>五、公司設置提名或薪酬委員會等功能委員會之運作情形</p>	<p>本公司已設置薪酬委員會，目前運作情形良好。</p>	<p>其他各類功能性委員會，本公司未來將視實際需要設置之。</p>												
<p>七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)：董監事及經理人進修情形請詳下方表格。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th><th>姓名</th><th>100年度進修時數</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事長</td><td>鄭再興</td><td>3小時</td></tr> <tr> <td>監察人</td><td>陳志祥</td><td>3小時</td></tr> <tr> <td>監察人</td><td>鄭玉慧</td><td>3小時</td></tr> </tbody> </table> <p>本公司尚未為董事及監察人購買責任保險。</p> <p>本公司董事出席及監察人列席董事會情形良好。</p> <p>本公司風險管理政策及風險衡量標準皆有專人負責，執行情形良好。</p> <p>本公司設有專責客戶服務人員及品保部協助客戶售後服務及客訴處理。</p>			職稱	姓名	100年度進修時數	董事長	鄭再興	3小時	監察人	陳志祥	3小時	監察人	鄭玉慧	3小時
職稱	姓名	100年度進修時數												
董事長	鄭再興	3小時												
監察人	陳志祥	3小時												
監察人	鄭玉慧	3小時												
<p>八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形：無此情形。</p>														

(四) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

組成	職責	運作情形
<p>一、本公司於100年12月22日經董事會決議通過設立薪酬委員會，聘任薪酬委員共計3人，任期與聘任當期董事會任期相同。</p> <p>二、現任薪酬委員會內其中二名為本公司獨立董事，另一名為符合法定資格之外聘人員。</p>	<p>一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。</p> <p>二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。</p>	<p>一、本公司薪酬委員會自成立後至公開說明書刊印日止已開會兩次。</p> <p>二、會議規則均遵照薪酬委員會章程執行。</p> <p>三、三位委員均全程參與會議。</p>

(五) 履行社會責任情形：公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形：

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
<p>一、落實推動公司治理</p> <p>(一) 公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。</p> <p>(二) 公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形。</p> <p>(三) 公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。</p>	<p>(一)本公司尚未訂定社會責任政策或制度。</p> <p>(二)本公司設有管理處部門兼職推動企業社會責任。</p> <p>(三)本公司尚未定期舉辦相關宣導與教育訓練等事項，因此，目前尚無相關事項與員工考績結合。</p>	符合上市上櫃公司企業社會實務守則規定。
<p>二、發展永續環境</p> <p>(一) 公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。</p> <p>(二) 公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。</p> <p>(三) 設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。</p> <p>(四) 公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。</p>	<p>(一)本公司採用LED燈具以及節能空調系統，以減少環境損害。</p> <p>(二)本公司之產品特性並不會造成環境汙染，相關防制措施均執行良好。</p> <p>(三)本公司設立管理處部門，隨時注意維護公司所處環境。</p> <p>(四)本公司平日採取限制空調系統，以溫度調節，避免長時間使用空調系統。</p>	符合上市上櫃公司企業社會實務守則規定。
<p>三、維護社會公益</p> <p>(一) 公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，建立適當之管理方法與程序之情形。</p> <p>(二) 公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。</p> <p>(三) 公司制定並公開其消費者權益政</p>	<p>(一)本公司有關勞資關係之一切規定措施，均依照相關法令實施，故勞資關係良好，任何有關勞資關係之新增或修正措施，均經勞資雙方充分協議溝通後才定案，故無任何爭議發生。</p> <p>(二)本公司採人性化管理，為尊重員工，特別設有溝通座談會、意見箱、部門會議等多種溝通管道，供同仁與各級主管做單向或雙向的意見表達或</p>	符合上市上櫃公司企業社會實務守則規定。

<p>策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。</p> <p>(四) 公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。</p> <p>(五) 公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。</p>	<p>溝通。</p> <p>(三) 本公司重視員工所處工作環境的安全與健康，安排員工定期健康檢查，並定期實施如消防安全等之教育訓練。</p> <p>(四) 本公司並未明確制定消費者權益政策，惟設立客服部門，協助處理消費者各項申訴。</p> <p>(五) 由於本公司主要供應商為美國、日本廠商，因此目前尚未與主要供應商合作致力提升企業社會責任。</p> <p>(六) 本公司積極參與社區服務與社會服務，熱心公益，定期與政府機關合作，固定提供身心障礙學生校外實習及就業機會，亦鼓勵員工工作之餘參與社會公益活動，此外，本公司積極參與廠房週邊綠化活動。</p>	
---	--	--

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一) 公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。</p> <p>(二) 公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。</p>	<p>(一) 本公司定期將公司履行之社會責任揭露於年報與公司網站內。</p> <p>(二) 目前公司尚未編制企業社會責任報告書。</p>	<p>(一) 符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。</p> <p>(二) 將視實際需要，適時辦理。</p>
<p>五、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：</p> <p>1. 環保政策、安全衛生與相關運作情形：本公司主要從事表面黏著元件封裝用之上、下膠帶及紙帶加工製造，並導入RoHS規範要求，依法令規定非屬現階段水污染、空氣污染防治公告之事業種類，並無環境污染之虞。此外，本公司平時對於工廠週遭環境即予以妥善維持，且完全符合經濟部加工出口區管理處環保單位之要求。</p> <p>2. 本公司始終秉持根留台灣的理念，落實企業社會責任，全數採用本國勞工，提供在地工作機會。</p> <p>3. 本公司積極參與社區服務與社會服務，熱心公益，定期與政府機關合作，固定提供身心障礙學生校外實習及就業機會，亦鼓勵員工工作之餘參與社會公益活動，此外，本公司積極參與廠房週邊綠化活動。</p> <p>參與事蹟大致條列如下：</p> <p>(1) 熱心贊助中華民國表面黏著技術協會嘉惠業界。</p> <p>(2) 雷科提供國立高雄第一科技大學教學研究環境。</p> <p>(3) 熱心贊助國立中山大學財務管理學系財管生活營活動經費。</p> <p>(4) 贊助國立中山大學 EMBA Program 研究經費。</p> <p>(5) 捐贈慈濟慈善事業基金會 921 震災復建經費。</p> <p>(6) 參與認養經濟部加工出口區管理處公共綠地設施。</p> <p>(7) 捐贈創世社會福利基金會救助清寒植物人、失智、失能、失依老人、街頭流浪人。</p> <p>(8) 捐贈財團法人桃園縣私立華新瀚宇慈善基金會從事社會福利事業。</p> <p>(9) 贊助第十三、四屆國際比較管理學術會議經費。</p> <p>(10) 贊助 2004 年中小企業展望與對策研討會。</p> <p>(11) 提供長榮大學學生教學研究環境。</p> <p>(12) 贊助文具用品、書籍及生活用品給財團法人台灣省私立向上兒童福利基金會。</p> <p>(13) 晉用社團法人高雄市調色板協會濟貧弱智員工，並獲得教育部 94 年度提供身心障礙學生校外實習及就業愛心楷模廠商殊榮，目前持續晉用。</p>		
<p>六、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：</p> <p>本公司產品已通過ISO產品認證。</p>		

**(六) 公司履行誠信經營情形及採行措施：**

1. 本公司遵循公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。
2. 本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
3. 為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。
4. 此外，本公司亦提供適當管道，使得員工及其他人員得就不誠信行為提供改善建議，並隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，以作為本公司對於誠信原則之檢討改進之依據。

**(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：**

1. 本公司訂定「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、「董監事選舉辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證程序」、「董事、監察人及經理人道德行為準則」等規章。
2. 有關規章均已揭露於年報及議事手冊，可至公開資訊觀測站(<http://newmops.tse.com.tw>)查閱，也可至本公司網站(<http://www.lasertek.com.tw>)查閱。

**(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：**  
無。

## (九) 內部控制制度執行狀況

### 1. 內部控制聲明書

#### 雷科股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：101年3月28日

本公司民國 100 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估及回應，3. 控制作業，4. 資訊及溝通，及5. 監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國100年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國101年3月28日董事會通過，出席董事6人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

雷科股份有限公司

董事長： 簽章

總經理： 簽章

依據：公開發行公司建立內部控制制度處理準則第 24 條-首次辦理股票公開發行及公開發行公司，應每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性，並依規定格式作成內部控制制度聲明書於每會計年度終了後四個月內於本會指定網站辦理公告申報。前項內部控制制度聲明書應先經董事會通過；修正時，亦同。第一項內部控制制度聲明書應依規定刊登於年報、股票公開發行說明書及公開說明書。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：



資誠

雷科股份有限公司

內部控制制度審查報告

後附雷科股份有限公司民國 101 年 5 月 3 日謂經評估認為其與財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 101 年 3 月 31 日係有效設計及執行之聲明書，業經本會計師審查竣事。維持有效之內部控制制度及評估其有效性係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據審查結果對公司內部控制制度之有效性及上開公司之內部控制制度聲明書表示意見。

本會計師係依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及一般公認審計準則規劃並執行審查工作，以合理確信公司上述內部控制制度是否在所有重大方面維持有效性。此項審查工作包括瞭解公司內部控制制度、評估管理階層評估整體內部控制制度有效性之過程、測試及評估內部控制制度設計及執行之有效性，以及本會計師認為必要之其他審查程序。本會計師相信此項審查工作可對所表示之意見提供合理之依據。

任何內部控制制度均有其先天上之限制，故雷科股份有限公司上述內部控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外，未來之環境可能變遷，遵循內部控制制度之程度亦可能降低，故在本期有效之內部控制制度，並不表示在未來亦必有效。

依本會計師意見，依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制有效性判斷項目判斷，雷科股份有限公司與財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 101 年 3 月 31 日之設計及執行，在所有重大方面可維持有效性；雷科股份有限公司於民國 101 年 5 月 3 日所出具謂經評估認為其上述與財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面則屬允當。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林億彰

林億彰

會計師

王國華

王國華

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(87)台財證(六)第 68790 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(79)台財證(一)第 37504 號

中 華 民 國 1 0 1 年 5 月 2 9 日

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部相關人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：本公司無此情事發生。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 一〇〇〇年股東常會  
時 間：民國一〇〇〇年六月九日上午九時  
重要決議：
  - (1) 章程修訂案。
  - (2) 九十九年度盈餘分配案。
  - (3) 資本公積轉增資發行新股。
  - (4) 補選董事案。
2. 一〇〇〇年董事會  
時 間：民國一〇〇〇年一月十四日上午十點  
重要決議：
  - (1) 決議對間接轉投資東莞泰普電子科技有限公司增資案。
  - (2) 購置新竹辦公室樓房。
  - (3) 決議間接轉投資深圳富威強實業有限公司。
3. 一〇〇〇年董事會  
時 間：民國一〇〇〇年三月二十一日上午九點三十分  
重要決議：
  - (1) 決議章程修訂。
  - (2) 決議股東會召開事宜。
4. 一〇〇〇年董事會  
時 間：民國一〇〇〇年四月十八日上午十點  
重要決議：
  - (1) 承認九十九年度財務報表與盈餘分配案。
  - (2) 決議資本公積轉增資。
  - (3) 決議發行國內第四次無擔保轉換公司債。
5. 一〇〇〇年董事會  
時 間：民國一〇〇〇年六月九日上午九點三十分  
重要決議：
  - (1) 決議增加雷育電子塑膠材料(蘇州)有限公司投資案。
  - (2) 決議對間接轉投資雷科電子材料(昆山)有限公司增資案。
6. 一〇〇〇年董事會  
時 間：民國一〇〇〇年七月二十八日上午十點  
重要決議：
  - (1) 決議除權、除息基準日及增資基準日。
7. 一〇〇〇年董事會  
時 間：民國一〇〇〇年八月二十二日上午十點  
重要決議：
  - (1) 決議買回本公司股份。



8. 一〇〇年董事會

時 間：民國一〇〇年十月十四日上午十點

重要決議：

- (1) 決議註銷股本與減資基準日。
- (2) 決議買回本公司股份。

9. 一〇〇年董事會

時 間：民國一〇〇年十一月二十九日上午十點

重要決議：

- (1) 決議間接轉投資設立東莞塘廈雷科電子科技有限公司。

10. 一〇〇年董事會

時 間：民國一〇〇年十二月二十二日上午十點

重要決議：

- (1) 決議訂定薪資報酬委員會組織章程與聘請委員。

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者：  
本公司無此情事發生。

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士（包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等）辭職解任情形之彙總：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
稽核主管	何淑莉	98.8.27	100.11.23	健康因素離職

#### 四、會計師公費資訊

(一) 公司給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：本公司均未超過

會計師事務所名稱	會計師姓名	查核期間
資誠聯合會計師事務所	林億彰 王國華	100.1.1~100.12.31

金額單位：新臺幣千元

公費項目 金額級距		審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 千元	1,340	-	1,340
2	2,000 千元（含）~4,000 千元			
3	4,000 千元（含）~6,000 千元			
4	6,000 千元（含）~8,000 千元			
5	8,000 千元（含）~10,000 千元			
6	10,000 千元（含）以上			

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：本公司最近年度並無更換會計師。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：本公司支付之審計公費並未減少。

**五、更換會計師資訊：**

(一) 關於前任會計師：無。

(二) 關於繼任會計師：無。

(三) 前任會計師之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：  
本公司無此情事發生。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一) 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

職稱	姓名	100 年度		101 年度 截至 5 月 29 日止	
		持有股數增 (減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董 事 長	普雷氏投資(股)公司 代表人：鄭再興	542,320	0	0	(650,000)
董 事	順治投資(股)公司 代表人：莊凱婷	58,910	0	0	0
董 事	傅新喬	23,247	0	0	0
董 事	吳袖田(註 1)	0	0	0	0
董 事 兼 設備總經理	黃萌義	14,411	0	(3,000)	0
獨 立 董 事	劉德明	0	0	0	0
獨 立 董 事	黃來福	2,444	0	0	0
監 察 人	鄭玉慧	14,105	0	0	0
監 察 人	陳志祥	66,505	0	0	0
獨立監察人	徐守德	0	0	0	0
總 經 理	林昭雄	(1,960)	0	0	0
總 經 理	李雨龍(註 2)	0	0	0	0
副 總 經 理	林庭聿(註 3)	0	0	0	0
副 總 經 理	吳新建(註 4)	0	0	0	0
副 總 經 理	張志賓(註 5)	0	0	0	0
副 總 經 理	劉滄雅(註 6)	(5,393)	0	0	0
副 總 經 理	熊學毅(註 7)	5,495	0	0	0
財 務 主 管	唐靜玲	(10,618)	0	(1,000)	0

註 1：於 99 年 6 月 4 日新任，於 100 年 4 月 18 日辭任。

註 2：於 99 年 2 月 1 日到任，於 100 年 6 月 30 日辭職。

註 3：於 99 年 9 月 30 日辭職。

註 4：於 99 年 2 月 1 日到任，於 99 年 9 月 1 日辭職。

註 5：於 99 年 2 月 1 日到任，於 100 年 5 月 13 日辭職。

註 6：於 99 年 1 月 4 日到任，於 100 年 11 月 10 日辭職。

註 7：於 100 年 4 月 1 日到任

(二) 股權移轉或股權質押之相對人為關係人應揭露資料：

本公司董監事股權移轉與質押之相對人均非關係人，故不適用。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

101年5月29日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
普雷氏投資股份有限公司	5,901,038	7.63%	0	0	0	0	禾興投資(股)公司 兩龍投資(股)公司	董事長為同一人 董事長互為姐弟關係	—
禾興投資股份有限公司	3,159,113	4.08%	0	0	0	0	普雷氏投資(股)公司 兩龍投資(股)公司	董事長為同一人 董事長互為姐弟關係	—
兩龍投資股份有限公司	2,975,401	3.85%	0	0	0	0	普雷氏投資(股)公司 禾興投資(股)公司	董事長互為姐弟關係	—
鐘艷秋	1,686,834	2.18%	0	0	0	0	無	無	—
李念龍	1,150,000	1.49%	0	0	0	0	無	無	—
李季鞠	1,127,323	1.46%	0	0	0	0	無	無	—
滙豐託管EFG銀行—香港分行投資專戶	1,101,203	1.42%	0	0	0	0	無	無	—
張中皇	885,353	1.14%	0	0	0	0	無	無	—
李偉崇	878,686	1.14%	0	0	0	0	無	無	—
陳志祥	723,652	0.94%	14,813	0.02%	0	0	無	無	—

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數與綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
SMD PACKAGING L.L.C.	註	100%	0	0	0	100%
LASER TEK(SINGAPORE) PTE.LTD	3,820	100%	0	0	3,820	100%
節研節能股份有限公司	4,000	100%	0	0	4,000	100%
SMD INTERNATIONAL CO., LTD.	3,970	100%	3,970	100%	3,970	100%
LASER TEK INTERNATIONAL CO., LTD.	1,906	100%	1,906	100%	1,906	100%
普雷(上海)貿易有限公司	註	100%	0	100%	0	100%
雷科(廈門)電子材料有限公司	註	100%	0	100%	0	100%
威克半導體股份有限公司	2,600	100%	2,600	100%	2,600	100%
JIANWEITE INTERNATIONAL CO., LTD.	註	100%	0	100%	0	100%
GAIN INTERNATIONAL CO.,LTD.	註	100%	0	100%	0	100%
雷育電子塑膠材料(蘇州)有限公司	註	100%	0	100%	0	100%
LAMDA GROUP L.L.C.	註	100%	0	100%	0	100%
深圳市富威強實業有限公司	註	100%	0	100%	0	100%
FU WAH COMPANY LIMITED	註	100%	0	100%	0	100%
東莞國創電子有限公司	註	65%	0	100%	0	65%
雷科電子材料(昆山)有限公司	註	100%	0	100%	0	100%
東莞泰普電子科技有限公司	註	100%	0	100%	0	100%
東莞塘廈雷科電子科技有限公司	註	100%	0	100%	0	100%

註：屬有限公司型態，故無股數。

## 肆、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一) 股本來源及種類：最近五年度及截至刊印日止股本變動情形

單位：股；新台幣元/101年4月21日

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數(股)	金額(元)	股數(股)	金額(元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
95.02	10	90,000,000	900,000,000	63,815,307	638,153,070	庫藏股減資(註1)	—	—
96.08	10	90,000,000	900,000,000	68,206,072	682,060,720	盈餘轉增資(註2)	—	—
97.08	10	90,000,000	900,000,000	71,734,314	717,343,140	盈餘轉增資(註3)	—	—
98.02	10	90,000,000	900,000,000	69,530,614	695,303,140	庫藏股減資(註4)	—	—
98.08	10	90,000,000	900,000,000	71,591,804	715,918,040	盈餘轉增資(註5)	—	—
99.09	10	120,000,000	1,200,000,000	75,659,450	756,594,500	盈餘轉增資(註6)	—	—
100.02	—	90,000,000	900,000,000	75,691,631	756,916,310	轉換公司債轉換普通股(註7)	—	—
100.05	—	90,000,000	900,000,000	75,781,283	757,812,830	轉換公司債轉換普通股(註8)	—	—
100.08	—	90,000,000	900,000,000	76,606,559	766,065,590	轉換公司債轉換普通股(註9)		
100.09	10	90,000,000	900,000,000	84,175,722	841,757,220	盈餘轉增資(註10)		
100.11	10	90,000,000	900,000,000	80,175,722	801,757,220	庫藏股減資(註11)		
101.03	10	90,000,000	900,000,000	77,375,722	773,757,220	庫藏股減資(註12)		

註1：95年3月15日加授高字第09500300370號。

註2：96年8月20日加授高字第09600302270號。

註3：97年8月22日加授高字第09700302180號。

註4：98年2月17日加授高字第09800300330號。

註5：98年8月3日加授高字第09800302000號。

註6：99年9月3日加授高字第09900302350號。

註7：100年2月1日加授高字第10000300300號。

註8：100年5月6日加授高字第10000301330號。

註9：100年8月11日加授高字第10000302360號。

註10：100年9月30日加授高字第10000302650號。

註11：100年11月22日加授高字第10000303080號。

註12：101年4月19日加授高字第10100300860號。

101年4月19日/單位：股

股份種類	核定股本			備註
	已發行股份	未發行股份	合計	
普通股	77,375,722	12,624,278	90,000,000	已發行股數均為上櫃股票

#### (二) 股東結構

101年5月29日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及 外人	合計
人數	0	0	34	9,519	9	9,562
持有股數	0	0	15,727,745	59,546,226	2,101,751	77,375,722
持股比例(%)	0	0	20.33	76.96	2.71	100.00

註：含已買回尚未註銷或轉讓之庫藏股票 1,567,000 股。

(三) 股權分散情形

每股面額十元

101 年 4 月 21 日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例 (%)
1 至 999	4,268	774,195	1.00
1,000 至 5,000	3,383	7,170,425	9.27
5,001 至 10,000	820	5,668,595	7.33
10,001 至 15,000	450	5,374,612	6.95
15,001 至 20,000	156	2,710,837	3.50
20,001 至 30,000	167	3,987,464	5.15
30,001 至 40,000	81	2,813,332	3.64
40,001 至 50,000	59	2,610,734	3.37
50,001 至 100,000	88	6,139,994	7.94
100,001 至 200,000	40	5,512,022	7.12
200,001 至 400,000	32	9,451,447	12.22
400,001 至 600,000	4	2,028,609	2.62
600,001 至 800,000	4	2,701,505	3.49
800,001 至 1,000,000	2	1,764,039	2.28
1,000,001 以上	8	18,667,912	24.12
合計	9,562	77,375,722	100.00

註：含已買回公司股份尚未註銷或轉讓 1,567,000 股。

(四) 主要股東名單

持股5 %以上或股權比率佔前十名之主要股東名單

101 年 4 月 21 日

主要股東名稱	持有股數	持股比例%
普雷氏投資股份有限公司	5,901,038	7.63%
禾興投資股份有限公司	3,159,113	4.08%
雨龍投資股份有限公司	2,975,401	3.85%
鐘艷秋	1,686,834	2.18%
李念龍	1,150,000	1.49%
李季鞠	1,127,323	1.46%
滙豐託管 E F G 銀行－香港分行投資專戶	1,101,203	1.42%
張中皇	885,353	1.14%
李偉崇	878,686	1.14%
陳志祥	723,652	0.94%

## (五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘及股利資料

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度		99 年度	100 年度
每股市價 (註1)	最高	55.20	54.20
	最低	27.60	25.60
	平均	42.67	46.69
每股淨值 (註2)	分配前	16.96	16.18
	分配後	—	—
每股盈餘	加權平均股數(仟股)		69,592
	每股盈餘 (註3)	追溯調整前	3.92
		追溯調整後	3.55
每股股利	現金股利		2.00
	無償 配股	盈餘配股	—
		資本公積配股	1.00
	累積未付股利(註4)		—
投資報酬 分 析	本益比(註5)		10.89
	本利比(註6)		21.34
	現金股利殖利率(註7)		4.69%

註1：各年度普通股最高及最低市價，並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

註2：100年度盈餘分配業經董事會通過，惟尚未經股東常會決議。

註3：因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。

註4：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註5：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註6：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註7：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

## (六) 股利政策及執行狀況

### 1. 公司章程訂定之股利政策：

本公司盈餘分派係依公司章程及主管機關規定，並配合當年度盈餘狀況，以股利穩定為原則，考量公司長期發展計畫及整體環境與產業成長特性，同時兼顧股東權益及滿足股東對現金流入之需求，本公司於每年度決算後所得純益，除依法繳納營利事業所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就餘額依法提撥百分之十法定盈餘公積，得視公司營運需要及法令規定酌提特別盈餘公積，如尚有餘額就其中再提撥百分之一至五為董監酬勞金，百分之二至十五為員工紅利，員工紅利得以股票方式發給，發給對象包括從屬公司之員工，其餘為股東紅利。為達平衡穩定之股利政策，公司分派股東紅利時，採盈餘轉增資或現金股利等配合，其比率主要係考量公司之現金流量、股本擴充情形、未來擴展營運規模之需要及股東權益而訂定，但現金股利發放比率不低於當次配發股東紅利總額之百分之二十。當年度如有將依法令提列之特別盈餘公積迴轉者，則可併入可分配的盈餘分派給股東。

2.100 年股東常會擬議分配股利之情形（經董事會通過，尚未經股東會通過）：

本公司 100 年度盈餘分配，經 101 年 5 月 3 日董事會決議通過，擬發放股東股利 113,712 仟元，其中每股股票股利 0.75 元及每股現金股利 0.75 元，員工紅利及董監酬勞分別為 8,251 仟元及 2,888 仟元，惟尚未經股東會決議。

盈餘分配表  
民國 100 年度

單位：新台幣元	
項目	金額
期初未分配盈餘	\$ 20,694,336
減：庫藏股註銷沖減保留盈餘	(79,388,568)
加：本年度稅後淨利	209,189,671
減：提列法定公積	(15,049,544)
加：迴轉特別盈餘公積	51,931,621
本期可分配盈餘	187,337,516
本期分配項目	
股東紅利-現金股利（每股配發 0.75 元）	(56,856,540)
股東紅利-股票股利（每股配發 0.75 元）	(56,856,540)
期末未分配盈餘	\$ 73,664,436
備註	
員工分紅	\$ 8,251,355
董監酬勞	\$ 2,887,974

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：

本公司股利政策近期與預期未來並未有重大變動。

（七）本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司 100 年度之稅後純益為 209,190 仟元，就流通在外加權平均股數 80,367 仟股計算，每股盈餘為 2.60 元，若以 100 年度之獲利不考慮 101 年度之業績成長，在增加無償配股後，推估每股盈餘為 2.38 元，故本公司在營運持續成長下，獲利亦將提昇，整體而言，100 年度無償配股對本公司營業績效及每股盈餘應無重大影響。

（八）員工分紅及董事、監察人酬勞

1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

依本公司章程規定於每年度決算後所得純益，除依法繳納營利事業所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就餘額依法提撥百分之十法定盈餘公積，得視公司營運需要及法令規定酌提特別盈餘公積，如尚有餘額就其中再提撥百分之一至五為董監酬勞金，百分之二至十五為員工紅利，員工紅利得以股票方式發給，發給對象包括從屬公司之員工。



2. 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票股利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

員工紅利及董事、監察人酬勞金額估列基礎係每年度稅後純益於彌補虧損後，應先提撥 10%法定盈餘公積，並視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，如尚有餘額就其中再提撥 1%至 5%為董監酬勞金，2%至 15%為員工紅利，員工紅利得以股票方式發給。而配發股票紅利之股數計算基礎係依據股東會決議前一日之收盤價並考量除權除息之影響。惟若嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，列為實際分配年度之損益。

3. 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：

- (1) 配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額：

民國 100 年盈餘分派案，業經本公司 101 年 5 月 3 日董事會決議，其中擬議配發之員工紅利與董監事酬勞之相關資訊如下：

單位：新台幣元

項 目	金 額	與認列費用估列年度是否有差異
董監事酬勞	2,887,974	並無差異
員工紅利-股票	8,251,355	並無差異

- (2) 擬議配發員工股票紅利金額及佔本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例：本公司 100 年度擬發放員工現金紅利，故不適用。

- (3) 考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：因應員工紅利及董事、監察人酬勞已費用化，故不適用。

4. 上一年度員工紅利及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因：

本公司 99 年度員工紅利及董監事酬勞之實際配發情形與原董事會通過之擬議配發情形說明如下：

單位：新台幣仟元

配發項目	原董事會 擬議配發數	股東會 決議實際配發數	差異數
員工股票紅利	-	-	-
員工現金紅利	26,369	25,010	未考量到提列 特別盈餘公積
董監事酬勞	9,229	8,337	

(九)公司買回本公司股份情形：

101.5.29

買回期次	第五次	第六次	第七次
買回目的	轉讓予員工	維護公司信用與股東權益	維護公司信用與股東權益
買回期間	99.11.8~99.12.16	100.8.25~100.10.4	100.10.18~100.12.13
買回區間價格	每股新台幣 40 元至 50 元	每股新台幣 40 元至 60 元	每股新台幣 30 元至 55 元
已買回股份種類及數量	普通股 2,427 仟股	普通股 4,000 仟股	普通股 2,800 仟股
已買回股份金額	新台幣 110,174 仟元	新台幣 152,408 仟元	新台幣 84,080 仟元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 2,204 仟股	普通股 4,000 仟股	普通股 2,800 仟股
累積持有本公司股份數量	1,567,000 股	0 股	0 股
累積持有本公司股份數量佔已發行股份總數比率(%)	2.03%	0%	0%

## 二、公司債辦理情形：

### (一)尚未償還及辦理中之公司債

公 司 債 種 類		國內第三次無擔保 轉換公司債	國內第四次無擔保 轉換公司債
發 行 日 期		99年7月8日	100年5月25日
面 額		新台幣 100 仟元	新台幣 100 仟元
發 行 及 交 易 地 點		不適用	不適用
發 行 價 格		依面額十足發行	依面額十足發行
總 額		新台幣 500,000 仟元	新台幣 600,000 仟元
利 率		0%	0%
期 限		5年期 到期日：104年7月8日	5年期 到期日：105年5月25日
保 證 機 構		無	無
受 託 人		兆豐國際商業銀行信託部	中國信託商業銀行信託部
承 銷 機 構		凱基證券股份有限公司	中國信託綜合證券股份有限公司
簽 證 律 師		誠理國際法律事務所 吳祝春律師	現代法律事務所 郭惠吉律師
簽 證 會 計 師		資誠聯合會計師事務所 吳漢朝、林億彰會計師	資誠聯合會計師事務所 劉子猛、林億彰會計師
償 還 方 法		除依轉換辦法轉換或贖回外，到 期時以現金一次還本	除依轉換辦法轉換或贖回外，到 期時以現金一次還本
未 償 還 金 額		新台幣 288,400 仟元	新台幣 508,200 仟元
贖回或提前清償之條款		請參閱發行及轉換辦法(附件一) 第十八條及第十九條	請參閱發行及轉換辦法(附件二) 第十八條及第十九條
限 制 條 款		請參閱發行及轉換辦法(附件一) 第十一條	請參閱發行及轉換辦法(附件二) 第十一條
信 用 評 等 機 構 名 稱、 評 等 日 期、 公 司 債 評 等 結 果		無	無
附 其 他 權 利	新台幣41,200仟元	新台幣0元	無
	請參閱後附發行及轉 換辦法 (附件一)	請參閱後附發行及轉換辦法 (附件二)	請參閱後附發行及轉換辦法 (附件二；第45頁~49頁)
對股權可能稀釋情形及對 現 有 股 東 權 益 影 響		稀釋比率約為13.06%，對股東權 益之影響尚屬有限。	稀釋比率約為12.88%，對股東權 益之影響尚屬有限。
交換標的委託保管機構名 稱		不適用	不適用

### (二)一年內到期之公司債：

依據本公司 99 年 7 月 8 日發行國內第三次無擔保轉換公司債轉換辦法第十八條，發行滿二年債權人得行使賣回權，因此一年到期之公司債金額為新台幣 288,400 仟元。。

(三)已發行附有得轉換為普通股、海外存託憑證或其他有價證券之轉換公司債

單位：新台幣元

公司債種類		第三次無擔保轉換公司債		第四次無擔保轉換公司債	
項目	年度	100 年度	101 年度 截至 3 月 31 日	100 年度	101 年度 截至 3 月 31 日
	轉 換 公 司 債 市 價				
	最 高	123.6	107.6	109.95	100.00
	最 低	100.5	100.5	99.80	100.00
	平 均	109.84	101.8	102.96	100.00
轉 換 價 格		43.5	37.8	53.6	46.5
發行（辦理）日期及 發行時轉換價格		發行日期：99 年 7 月 8 日 發行時轉換價格：46.8 元		發行日期：100 年 5 月 25 日 發行時轉換價格：53.6 元	
履行轉換義務方式		以發行新股方式交付		以發行新股方式交付	

(四)已發行交換公司債辦理情形：無。

(五)採總括申報方式募集與發行普通公司債辦理情形：無。

(六)已發行附認股權公司債辦理情形：無。

(七)最近三年度私募公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無

四、海外存託憑證發行情形：無

五、員工認股權憑證發行情形：無

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

## 附件一

# 雷科股份有限公司 國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法

### 一、債券名稱

雷科股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第三次無擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。

### 二、發行日期

民國99年7月8日(以下簡稱「發行日」)。

### 三、發行面額、張數及發行價格

本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，依面額十足發行，發行總額為新台幣伍億元整，共計伍仟張。

### 四、發行期間

發行期間五年，自民國99年7月8日開始發行，至民國104年7月8日到期(以下簡稱「到期日」)。

### 五、票面利率

本轉換公司債之票面利率0%。

### 六、還本日期及方式

除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十八條由債券持有人提前賣回，或依本辦法第十九條由本公司提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。

### 七、擔保情形

本債券為無擔保債券，惟如本債券發行後，本公司另發行或私募其他有擔保轉換公司債或有擔保附認股權公司債時，本債券亦將比照該有擔保轉換公司債或有擔保附認股權公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。

### 八、轉換標的

本公司之普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。

### 九、轉換期間

(一)債券持有人於本轉換公司債發行日後屆滿一個月之次日(民國99年8月9日)起，至到期日前十日(民國104年6月27日)止，除依法暫停過戶期間及本條第(二)項規定期間外，得依本辦法第十條、第十一條、第十三條規定將本轉換公司債轉換為本公司普通股。

(二)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，停止轉換。

### 十、請求轉換程序

(一)債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書」，註明轉換並檢同登載債券之存摺，由交易券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱「集保結算所」)提出申請，一經申請不得撤銷。集保結算所於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達本公司股務代理機構時即生轉換之效力。本公司股務代理機構於送達後五個營業日內，直接將本公司普通股股票撥入原債券持有人之集保帳戶。

(二)華僑及外國人持有本債券轉換為股票時，統由集保結算所採取帳簿劃撥方式辦理配發。

## 十一、轉換價格及其調整

### (一)轉換價格之訂定

本轉換公司債轉換價格之訂定，以民國99年6月30日為轉換價格訂定基準日，以基準日(不含)前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一為基準價格，再以基準價格乘以101%~105%為計算依據(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。基準日前如遇有除權或除息者，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後，實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。以民國99年6月30日為轉換價格訂定基準日，轉換溢價率為101%，本轉換公司債之轉換價格訂為每股新台幣46.8元。

### (二)轉換價格之調整

1. 本轉換公司債發行後，除因本公司履行本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券而換發普通股外，遇有本公司已發行(或私募)普通股股數增加時(包括但不限於以募集發行或以私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、合併或受讓他公司股份、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，本公司應依下列公式調整轉換價格(向下調整，向上則不調整。計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，並函請櫃檯買賣中心公告，於新股發行除權基準日(註1)調整之(有實際繳款作業者則於股款繳足日調整之)。如於現金增資發行新股之除權基準日後變更新股發行價格，則依更新後之新股發行價格重新按下列公式調整之，如經設算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格，則函請櫃檯買賣中心重新公告調整之。

$$\begin{array}{l} \text{調整後} \\ \text{轉換價格} \end{array} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times \text{已發行股數(註2)} + \text{每股繳款金額(註3)} \times \text{新股發行或私募股數}}{\text{已發行股數} + \text{新股發行股數或私募股數}}$$

註1：如為股票分割則為分割基準日，如係盈餘轉增資、資本公積轉增資及員工紅利轉增資，則為除權基準日。如為合併或受讓增資則於合併基準日調整，如係以私募辦理現金增資，或增加之股份係私募有價證券，則於私募有價證券交付日調整。如為詢價圈購辦理現金增資或現金增資參與海外存託憑證，則為股款繳足日調整。

註2：已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

註3：每股繳款額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款額為零。若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款額為合併基準日前依消滅公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發行新股，則每股繳款額為受讓之他公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係員工紅利轉增資，則每股繳款額為應以股東會前一日之收盤價，並考量除權除息之影響。

2. 本轉換公司債發行後，如遇當年度配發普通股現金股利占每股時價之比率超過1.5%時，應按所占每股時價之比率於除息基準日調降轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，本公司並應函請櫃檯買賣中心公告調轉後之轉換價格。本項規定不適用於除息基準日(不含)前已提出請求轉換者。其調整公式如下：

$$\text{調降後轉換價格} = \text{調降前轉換價格} \times (1 - \text{發放普通股現金股利占每股時價(註4)之比率})$$

註4：每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

3. 本轉換公司債發行後，遇有本公司以低於每股時價(註5)之轉換或認購價格再發行(或私募)具有普通股轉換權或認購權之各種有價證券時，本公司應依下列公式調整轉換價格(向下調整，向上則不調整。計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，並函請櫃檯買賣中心公告，於前述有價證券或認購權發行之日或私募有價證券交付日調整之。

$$\text{註5調整後轉換價格} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times \text{已發行股數(註6)} + \frac{\text{新發行(或私募)有價證券或認股權之轉換或認股價格} \times \text{新發行(或私募)有價證券或認股權可轉換或認購之股數}}{\text{每股已發行股數} + \text{新發行(或私募)有價證券或認股權可轉換或認購之股數}}$$

註5：每股時價為再發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券之訂價基準日(私募為有價證券交付日)之前一、三、五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。如訂價基準日前遇有除權或除息者，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格。

註6：已發行股數係指普通股已募集發行與私募股份，發行(或私募)具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券如係以庫藏股支應，則調整公式中之已發行股數應減除新發行(或私募)有價證券可轉換或認購之股數。

4. 本轉換公司債發行後，如遇本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，本公司應依下列公式調整轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，並函請櫃檯買賣中心公告，於減資基準日調整之。

$$\text{調整後轉換價格} = \text{調整前轉換價格} \times \frac{\text{減資前已發行普通股股數}}{\text{減資後已發行普通股股數}}$$

註7：已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

## 十二、本轉換公司債之上櫃及終止上櫃

本債券於發行日之前向櫃檯買賣中心申請上櫃買賣，並由本公司洽櫃檯買賣中心同意後公告之。本債券至全數轉換為普通股股份或全數由本公司買回或償還時終止上櫃。

## 十三、轉換後新股之上櫃

本轉換公司債經轉換後換發之普通股自交付日起於櫃檯買賣中心上櫃買賣，並由本公司洽櫃檯買賣中心同意後公告之。

## 十四、本公司應於每季結束後十五日內將前一季因本轉換公司債轉換所交付之普通股股票數額予以公告，且每季至少應向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次。

## 十五、轉換為本公司普通股時，若有不足壹股之股份金額，本公司將以現金償付(計算至新台幣元為止，角以下四捨五入)。

## 十六、轉換後之權利義務

除本辦法另有約定者外，請求轉換之債券持有人，於轉換請求生效後，其權利義務與持有本公司普通股股份之股東相同。

## 十七、轉換年度股利之歸屬

### (一)現金股利

1. 債券持有人於當年度一月一日起至當年度本公司現金股息停止過戶日前十五個營業日(不含)以前請求轉換者，轉換而得之普通股得參與當年度股東會決議發放之前一年度現金股利。
2. 於本公司現金股息停止過戶日前十五個營業日(含)起至現金股息除息基準日(含)止，停止轉換。
3. 債券持有人於當年度現金股息除息基準日翌日起至當年度十二月三十一日(含)請求轉換者，應放棄當年度股東會決議發放之前一年度現金股利而參與次年度股東會決議發放之當年度現金股利。

### (二)股票股利

1. 債券持有人於當年度一月一日起至當年度本公司無償配股停止過戶日前十五個營業日(不含)以前請求轉換者，轉換而得之普通股得參與當年度股東會決議發放之前一年度股票股利。
2. 於本公司無償配股停止過戶日前十五個營業日(含)起至無償配股除權基準日(含)止停止債券轉換。
3. 債券持有人於當年度無償配股除權基準日翌日起至當年度十二月三十一日(含)請求轉換者，應放棄當年度股東會決議發放之前一年度股票股利，而參與次年度股東會決議發放之當年度股票股利。



#### 十八、債券持有人之賣回權

本轉換公司債分別以發行滿二年（民國 101 年 7 月 8 日）及三年（民國 102 年 7 月 8 日）為債券持有人賣回基準日。本公司將於賣回基準日之三十日前，以掛號寄發一份「債券持有人賣回權行使通知書」予債券持有人（以「債券持有人賣回權行使通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本債券之投資人，則以公告方式為之），並函請櫃檯買賣中心公告本轉換公司債券持有人賣回權之行使，債券持有人得於公告後三十日內以書面通知本公司股務代理機構（於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑）要求本公司以債券面額之 101.0025%（發行滿兩年，實質收益率為 0.5%）或 101.5075%（發行滿三年，實質收益率為 0.5%）將其所持有之本轉換公司債以現金贖回。本公司受理賣回請求，應於賣回基準日後五個營業日內（如遇台北市證券集中交易市場或櫃檯買賣中心停止營業之日，則順延）以現金贖回本轉換公司債。

#### 十九、本公司之贖回權

- （一）本轉換公司債發行滿一個月後翌日（民國 99 年 8 月 9 日）起至發行期間屆滿前四十日（民國 104 年 5 月 28 日）止，本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十（含）以上時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」（前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為前述第九條之轉換期間）予債券持有人（以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之），贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃檯買賣中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內以現金贖回本轉換債。
- （二）本轉換公司債發行滿一個月後翌日（民國 99 年 8 月 9 日）至發行期間屆滿前四十日（民國 104 年 5 月 28 日）止，本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額之 10% 時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」（前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為前述第九條之轉換期間）予債券持有人（以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之），贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃檯買賣中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內以現金贖回本轉換債。
- （三）若債權人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構（於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑）者，本公司得按當時之轉換價格，以通知期間屆滿日為轉換基準日，將其所持有之本轉換債轉換為本公司普通股。

二十、所有本公司收回(包括由次級市場買回)、償還或已轉換之本轉換公司債將被註銷，不得再賣出或發行。

二十一、本轉換公司債及所換發之普通股均為記名式，其過戶、異動登記、設質、遺失等均依「公開發行股票公司股務處理準則」之規定，另稅賦事宜依當時稅務法規之規定辦理。

二十二、本轉換公司債由兆豐國際商業銀行為債券持有人之受託人，代表債券持有人之利益行使查核及監督本公司履行本轉換公司債發行事項之權責。凡持有本轉換公司債之債券持有人不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人之間所定受託契約規定、受託人之權利義務及本發行及轉換辦法，均予同意並授與受託人有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債券持有人得在營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。

二十三、若本公司發生下列情事，無論本轉換公司債是否已屆清償期限，均視為全部到期，則本轉換公司債之受託銀行得代本轉換公司債之債權人向本公司請求以面額償還。

(一)本公司所簽發之票據因存款不足遭退票(但經清償註記者不在此限)或經票據交換所通報為拒絕往來戶。

(二)本公司或第三人聲請本公司破產或重整程序時，或本公司之業務或經營發生經本轉換公司債債權人會議決議認定之重大不利變更。

(三)本公司停止正常營業，與解散、處分或轉讓其重要部份或全部資產、營業，以致無法清償本轉換公司債。

二十四、本轉換公司債由本公司之股務代理機構辦理轉換及還本事宜。

二十五、本轉換公司債之發行依證券交易法第八條規定，不印製實體債券。

二十六、本轉換公司債發行及轉換辦法如有未盡事宜之處，悉依相關法令辦理之。

## 附件二

### 雷科股份有限公司 國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法

#### 一、債券名稱

雷科股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第四次無擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。

#### 二、發行日期

民國一〇〇年五月二十五日(以下簡稱「發行日」)。

#### 三、債券面額

每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額發行。

#### 四、發行總額

新台幣陸億元整。

#### 五、發行期間

發行期間五年，自民國一〇〇年五月二十五日開始發行至一〇五年五月二十五日到期(以下簡稱「到期日」)。

#### 六、債券票面利率

票面年利率 0%。

#### 七、還本日期及方式

除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十條行使賣回權，及本公司依本辦法第十九條提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

#### 八、擔保情形

本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後本公司另發行其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。

#### 九、轉換標的

本公司之普通股，並以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新股以帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。

#### 十、轉換期間

債券持有人得於本轉換公司債發行滿一個月翌日(民國一〇〇年六月二十六日)起，至到期日前十日(民國一〇五年五月十五日)止，除本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止、辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止及其他依法暫停過戶期間外，隨時向本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股，並依本辦法第十一條、十七條規定辦理。本公司並應依櫃檯買賣中心規定之期限，於前述無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前將停止轉換之期間予以公告並函櫃檯買賣中心。

#### 十一、請求轉換程序

(一)債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」(註明轉換)，由交易券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱「集保公司」)提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入原債券持有人之集保帳戶。

(二)華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統由集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。

## 十二、轉換價格及其調整：

(一)本轉換公司債轉換價格之訂定，係以民國一〇〇年五月十七日為訂定轉換價格之基準日，以其前一個營業日、三個營業日及五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數孰低者乘以103%為計算依據（計算至新台幣角為止，以下四捨五入）。基準日前如遇有除權或除息者，經採樣用以計算轉換價格之收盤價應先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後至實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。發行時之轉換價格定為每股新台幣53.6元。

(二)本轉換公司債發行後，除本公司所發行或私募之具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外，遇有本公司已發行普通股股份增加時（包含現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓其他公司股份發行新股、股票分割、現金增資參與發行海外存託憑證及私募普通股股份增加等），轉換價格依下列公式調整（計算至新台幣角為止，以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整），並函請櫃檯買賣中心公告，於新股發行除權基準日公告，將於股款繳足日(註1)調整之，如於現金增資發行新股之除權基準日後變更新股發行價格，則依變更後之新股發行價格重新按下列公式調整，如經設算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格，則應函請櫃檯買賣中心重新公告。

$$\text{調整後轉換價格} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times \text{已發行股數(註2)} + \text{每股繳款額(註3)} \times \text{新股發行股數或私募股數}}{\text{已發行股數} + \text{新股發行股數或私募股數}}$$

註1：如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整；股票分割則於股票分割基準日調整；如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，則於發行完成日調整；另如係私募普通股股份增加，則於私募交付日調整。

註2：已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括已私募股數)，並減除本公司買回但尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

註3：新股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款額為合併基準日前依消滅公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓其他公司股份發行新股，則每股繳款額為受讓之他公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係員工紅利發行新股，則每股繳款額為股東會前一日之收盤價，並考量除權除息之影響。

(三)本轉換公司債發行後，如遇本公司配發普通股現金股利占每股時價之比率超過1.5%時，應按所占每股時價之比率於除息基準日按下列公式調降轉換價格，並應函請櫃檯買賣中心公告調整後之轉換價格。

$$\text{調降後轉換價格} = \text{調降前轉換價格} \times (1 - \text{發放普通股現金股利占每股時價之比率})$$

註：每股時價係以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數孰低者為準。

- (四)本轉換公司債發行後，遇有本公司以低於每股時價(註1)之轉換或認股價格再發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時，或非因辦理現金增資而賦予他人發行公司普通股認購權時，轉換價格依下列公式調整（計算至新台幣角為止，以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整），並函請櫃檯買賣中心公告，於前述有價證券或認股權發行之日或私募有價證券交付日調整之：

$$\text{調整後轉換價格} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times \text{已發行股數(註2)} + \frac{\text{新發行或私募有價證券或認股權之股數}}{\text{新發行或私募有價證券或認股權之股數}} \times \text{可轉換或認購之股數}}{\text{已發行股數} + \text{新發行或私募有價證券或認股權可轉換或認購之股數}}$$

註1：每股時價為再發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券之訂價基準日(私募為有價證券交付日)前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數孰低者。

註2：已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括已私募股數)，並減除本公司已買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

註3：再發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券如係以庫藏股支應，則調整公式中之已發行股數應減除新發行有價證券可轉換或認股之股數。

- (五)本轉換公司債發行後，如遇本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式計算調整後轉換價格，並函請櫃檯買賣中心公告，於減資基準日調整之：

$$\text{調整後轉換價格} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times \text{減資前已發行普通股股數}}{\text{減資後已發行普通股股數}}$$

註：已發行普通股股數包括已私募股數，並減除本公司買回但尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

### 十三、本轉換公司債之上櫃及終止上櫃

本轉換公司債於發行日之前向櫃檯買賣中心申請上櫃買賣，至全數轉換為普通股股份或全數由本公司買回或償還時終止上櫃。

### 十四、轉換年度股利之歸屬

- (一)債券持有人於當年度一月一日起至當年度本公司向櫃檯買賣中心洽辦現金股息除息公告日(無償配股停止過戶除權公告日)前三個營業日(不含)以前請求轉換者，參與當年度股東會決議發放之前一年度現金股利(股票股利)。
- (二)當年度本公司向櫃檯買賣中心洽辦現金股息除息(無償配股除權)公告日前三個營業日(含)起至現金股息除息(無償配股除權)基準日(含)止停止債券轉換。
- (三)債券持有人於當年度現金股息除息基準日(無償配股除權基準日)翌日起至十二月三十一日(含)以前請求轉換者，應放棄當年度股東會決議發放之前一年度現金股利(股票股利)，而參與次年度股東會決議發放之當年度現金股利(股票股利)。

## 十五、股本變更登記作業

本公司應於每季結束後十五日內，將前一季因本轉換公司債轉換所交付之股票數額予以公告，每季並應向公司登記之主管機關申請資本額變更登記至少一次。

## 十六、換股時不足壹股股份金額之處理

轉換為本公司普通股時，若有不足壹股之股份金額，本公司將以現金償付(計算至新台幣元為止，以下四捨五入)。

## 十七、轉換後之新股上櫃

本轉換公司債經轉換後換發之普通股自交付日起於櫃檯買賣中心上櫃買賣，並由本公司洽櫃檯買賣中心同意後公告之。

## 十八、轉換後之權利義務

轉換後之新股，其權利義務與本公司原已發行之普通股股份相同。

## 十九、本公司對本轉換公司債之收回權

(一)本轉換公司債發行滿一個月翌日(一〇〇年六月二十六日)起至到期日前四十日(一〇五年四月十五日)止，若本公司普通股在櫃檯買賣中心之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十者，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第十條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之投資人，則以公告方式為之)，且函知櫃檯買賣中心公告並於該期間屆滿時，按債券面額以現金收回全部債券。

(二)本轉換公司債發行滿一個月翌日(一〇〇年六月二十六日)起至到期日前四十日(一〇五年四月十五日)止，若本轉換公司債流通在外餘額低於新台幣陸仟萬元(原發行總額之10%)者，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第十條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之投資人，則以公告方式為之)，且函知櫃檯買賣中心公告並於該期間屆滿時，按債券面額以現金收回其全部債券。

(三)若債券持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)者，本公司得按當時之轉換價格，以通知期間屆滿日為轉換基準日，將其轉換公司債轉換為本公司普通股。

## 二十、債券持有人之賣回權

本轉換公司債以發行滿二年(一〇二年五月二十五日)及滿三年(一〇三年五月二十五日)之日為債券持有人賣回基準日，本公司應於賣回基準日之前三十日(一〇二年四月二十五日及一〇三年四月二十五日)，以掛號寄發一份「賣回權行使通知書」予債券持有人(以「賣回權行使通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之投資人，則以公告方式為之)，並函知櫃檯買賣中心公告本轉換公司債持有人賣回權之行使，債券持有人得於發行滿二年及滿三年之前三十日(一〇二年四月二十五日及一〇三年四月二十五日)內以書面通知本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑)要求本公司依債券面額加計利息補償金【滿二年為債券面額之101.0025%(實質收益率0.5%)，滿三年為債券面額之101.5075%(實質收益率0.5%)】，將其所持有之本轉換公司債以現金贖回。本公司受理賣回請求，應於賣回基準日後七個營業日內將款項以滙款或開立支票方式交付債券持有人。

二十一、所有本公司收回(包括由證券商營業處所買回)、償還或已轉換之本轉換公司債將被註銷，不再賣出或發行。

二十二、本轉換公司債及其所轉換之普通股均為記名式，其過戶、異動登記、設質、遺失等均依「公開發行股票公司股務處理準則」及公司法相關之規定，另稅賦事宜依當時之稅法規定辦理。

二十三、本轉換公司債由中國信託商業銀行信託部為債權人之受託人，以代表債券持有人之利益行使查核及監督本公司履行本轉換公司債發行事項之權責。凡本轉換公司債之債券持有人不論係於發行時認購或中途買受，對於本公司與受託人之間所定受託契約規定、受託人之權利義務及本發行及轉換辦法，均予同意並授與受託人有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債券持有人得在營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查詢。

二十四、本轉換公司債委由本公司股務代理機構辦理還本付息及轉換事宜。

二十五、本轉換公司債之發行依證券交易法第八條規定採帳簿劃撥交付，不印製實體債券。

二十六、本轉換公司債發行及轉換辦法如有未盡事宜之處，悉依相關法令辦理之。

## 七、資金運用計畫執行情形：

本公司並無私募有價證券情形，而前各次募資計畫均已執行完成且無計畫變更情事。另計畫實際完成日距本次案件申報時未逾三年者為99年度及100年度發行之國內轉換公司債，茲將其相關事項說明如下：

### (一) 99年發行第三次可轉換公司債

#### 1. 計畫內容

(1)主管機關核准日期及文號：行政院金融監督管理委員會99年6月10日金管證發字第0990028273號。

(2)計畫所需資金總額：新台幣500,000仟元。

(3)資金來源：發行國內第三次無擔保轉換公司債新台幣500,000仟元。

#### (4)計畫項目、運用進度及預計可能產生效益：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度		
			99 年度		
			第二季	第三季	第四季
償還銀行借款	99 年第三季	290,000	-	290,000	-
充實營運資金	99 年第三季	210,000	-	210,000	-
合 計		500,000	-	500,000	-
預計可能產生效益	(1)償還銀行借款 預計 99 年度可節省現金利息支出約 1,400 仟元，100 年後每年度可節省約 3,359 仟元。 (2)充實營運資金 用以支應本公司日常營運所需資金，強化財務結構並提升市場競爭力。預計 99 年可節省利息支出 1,339 仟元，100 年後每年可節省約 3,213 仟元。				

### 2.執行情形

單位：新台幣仟元

計畫項目	執行狀況		截至99年 第三季累計	說明
償還銀行借款	支用金額	預定	290,000	業依原訂進度執行完畢。
		實際	290,000	
	執行進度	預定	100.00%	
		實際	100.00%	
充實營運資金	支用金額	預定	210,000	業依原訂進度執行完畢。
		實際	210,000	
	執行進度	預定	100.00%	
		實際	100.00%	
合計	支用金額	預定	500,000	全數業依原訂進度執行完畢。
		實際	500,000	
	執行進度	預定	100.00%	
		實際	100.00%	



### 3. 執行效益

本公司99年第三季發行轉換公司債，於募足款項後即依資金運用進度償還銀行借款290,000仟元，使得99年底之長期資金占固定資產比率由98年底之1,128.64% 提高至1,834.41%(參下表)，而流動比率及速動比率亦分別從98年底之87.09%及73.74%提高至99年底之147.74%及128.12%，另利息保障倍數則由98年度之9.4倍攀升至20.07倍，顯見本公司之長期資金結構及償債能力均已有效改善，至於負債比率方面，因發行公司債及銀行借款皆屬負債科目，在公司債尚未轉換為普通股下，對負債比率並無影響，然於轉換公司債持有人陸續行使轉換權，本公司負債比率可望逐漸降低，而99年底負債比率攀升，主係該年度營收大幅成長，購料及進貨等所產生之應付款項亦增加，使負債總額上升所致；整體觀之，本公司前次募集資金於償還銀行借款後，流動比率、速動比率、利息保障倍數及長期資金占固定資產比率均較前一年度大幅提升，對償債能力及財務結構改善實具正面助益。

此外，藉由該等資金之挹注以充實營運資金下，本公司99年下半年度之營業收入得以較98年度同期增加178,268仟元，業績成長44.84%，另本公司99年度之平均借款利率為1.16%，依此估算其前次募集資金500,000仟元用於償還銀行借款及充實營運資金，約節省利息支出2,417仟元。

綜上所述，由於本公司募資後償債能力及財務結構已獲改善，且業績明顯成長，亦有效節省利息支出，故前次募資計畫之效益應已顯現。

項目 \ 年度		98年度	99年度
財務結構	長期資金占固定資產比率	1,128.64%	1,834.41%
	負債比率	47.97	54.56
償債能力	流動比率	87.09	147.74%
	速動比率	73.74	128.12%
	利息保障倍數	9.4倍	20.07倍

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告

#### (二)100年發行第四次可轉換公司債

##### 1.計畫內容

(1)主管機關核准日期及文號：行政院金融監督管理委員會100

年5月10日金管證發字第1000017186號。

(2)計畫所需資金總額：新台幣600,000仟元。

(3)資金來源：發行國內第四次無擔保轉換公司債新台幣600,000仟元。

(4)計畫項目、運用進度及預計可能產生效益：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度		
			100 年度		
			第二季	第三季	第四季
償還銀行借款	100 年第二季	346,000	346,000	-	-
充實營運資金	100 年第三季	254,000	63,500	190,500	-
合 計		600,000	409,500	190,500	-
預計可能產生效益	(1)償還銀行借款 預計 100 年度可節省現金利息支出約 2,227 仟元，101 年後每年度可節省約 4,454 仟元。 (2)充實營運資金 用以支應本公司日常營運所需資金，強化財務結構並提升市場競爭力。預計 100 年可節省利息支出 1,431 仟元，100 年後每年可節省約 3,269 仟元。				

## 2.執行情形

單位：新台幣仟元

計畫項目	執行狀況			說明
償還銀行借款	支用金額	預定	346,000	於100年第三季執行完成，較原定時程略晚1季，係因配合銀行內部程序，相關作業遞延所致。
		實際	346,000	
	執行進度	預定	100.00%	
		實際	100.00%	
充實營運資金	支用金額	預定	254,000	業依原訂進度於100年第三季執行完畢。
		實際	254,000	
	執行進度	預定	100.00%	
		實際	100.00%	
合計	支用金額	預定	600,000	
		實際	600,000	
	執行進度	預定	100.00%	
		實際	100.00%	

### 3.執行效益

本公司100年第二季發行轉換公司債，於募足款項後即依資金運用進度償還銀行借款，惟因相關進度因配合融資銀行內部程序，還款相關作業稍遲，故償還銀行借款作業較原訂進度略晚1季，另充實營運資金部分業已按原訂進度於100年第3季執行完成。

本公司上述資金募集完成後，100年下半年度全球景氣即面臨歐債危機之衝擊，在整體經濟趨緩之情形下，本公司所發行之公司債即尚未轉換為普通股，然本公司著眼於長期發展規劃且為積極拓展相關業務，於北部及南部地區均有購置廠房，導致100年9月底之長期資金占固定資產比率較99年底下滑；至於負債比率方面，100年9月底之負債比率較99年底小幅增加，主因發行公司債及銀行借款皆屬負債科目，在公司債尚未轉換為普通股下，對負債比率並無影響，然於轉換公司債持有人陸續行使轉換權後，本公司之負債比率即可望逐漸降低；另本公司100年9月底之流動比率及速動比率均較100年底者增加，主係本公司前已發行之公司債受整體景氣趨緩，尚未轉換為普通股，而部分轉列至流動負債項下所致。惟本公司藉由該等資金之挹注以充實營運資金下，仍足以力抗歐債危機之衝擊，100年下半年度之營業收入係較99年同期增加22,574仟元，成長約4%；另本公司100年度之平均借款利率為1.36%，依此估算其前次募集資金600,000仟元用於償還銀行借款及充實營運資金，約已節省利息支出2,417仟元。故由營收成長及利息費用撙節之角度觀之，其資金運用對本公司係有正面效益。

年度		99年底	100年9月底
財務 結構	項目		
	長期資金占固定資產比率	1,834.41%	1,167.45%
償債 能力	負債比率	54.56%	59.28%
	流動比率	147.74%	116.86%
	速動比率	128.12%	100.06%

## 伍、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1. 所營業務主要內容

- 雷射精密加工
- 雷射修整機製造加工及銷售業務。
- 測試探針卡設計製造加工及銷售業務。
- 印刷資材(網板、銅板)之製造加工銷售業務。
- 一般進出口貿易業務(許可業務除外)。
- C601040加工紙業。
- CC01080電子零組件製造業。
- C805020塑膠膜、袋製造業。
- F109060包裝材料批發業。
- IZ06010理貨包裝業。
- F119010電子材料批發業。
- E903010防蝕防銹工程業。
- CC01120資料儲存媒體製造及複製業。
- F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- E603090 照明設備安裝工程業。
- F113020 電器批發業。
- CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- ZZ99999除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

##### 2. 公司目前之商品(服務)項目：

- SMD 表面黏著元件(Surface Mounted Device)晶片封裝紙帶、上下膠帶、半導體封裝材料 (Emboss cover tape、Embossed carrier tape)。
- SMT 表面黏著技術(Surface Mount Technology)錫膏測厚儀、AOI 自動光學檢查系統、雷射半自動雕刻機。
- 鐳射劃線機(Laser Scribe)、厚膜雷射調阻機(使用 IRLASER)、薄膜雷射調阻機(GREEN LASER)、鐳射晶片修阻機(Chip Trimmer)、鐳射功能性修阻機(Function Trimmer)。
- 三機一體(包含打孔機、測試機、捲帶機)功能設計之包裝包裝機。
- LED 自動測試包裝機、LED 亮度分選機。
- LED 燈具批發銷售。
- 電力線通訊(Power Line Communication)、防刮抗眩保護膜。
- 電子測試治具。

3. 100 年度主要產(商)品或營業項目占公司目前主要業務之營業比重：

單位：新台幣仟元

營業項目	100 年度	
	金額	比重(%)
SMD 封裝材料	383,619	30.57
SMT 製品	456,518	36.38
鐳射製品	101,467	8.08
半導體設備	77,033	6.14
其他	236,308	18.83
合 計	1,254,945	100.00

4. 計劃開發之新產(商)品或服務：

【1】計劃開發之新商品(服務)：

產品名稱	內容
Uv微盲孔鑽孔機	因應多層軟性電路板高密度內部微連結製程的需要，在銅箔上需要精密的微盲孔或穿孔的快速加工方案，此技術目前只有美國廠商ESI單一廠商能夠做到，因此我部門開始進行研發更高效率的新款機型。
IR鐳射焊接機	現今的智慧手機為提高更好的品質，會在原PCB板上再焊上一個鐵製遮蔽盒，目的在保護內部元件不受外界干擾，能更順暢的運作，焊接鐵盒必須仰賴人工操作，開始著手研發自動化鐳射焊接機來取代人工作業，目前實驗階段已接近完成。
IR鐳射除圍膠機	BGA返修過程，摘除BGA時的人工作業，非常容易導致報廢，藉此研發雷射除圍膠機，用鐳射非接觸式的方式先將固定膠劃出一道深溝，如此摘除BGA，可減少報廢率更可提高產能，目前相關部件已進入採購階段。
Green鐳射電感鑽孔機	將green鐳射導入0201電感鑽孔製程，目前已完成實驗階段，待軟硬體整合後即可完成。
Ball Screw劃線機	開發滾珠螺桿劃線機，將可提升劃線速度20%，目前已完成硬體結構，要提升至最高速的極限，軟體仍待測試。
雷射頻率修整機	精密雷射頻率修整機，以修整石英振盪器頻率為主。
Robot 機械臂	導入三軸 robot 機械臂取代傳統流道應用。
多頭鐳射應用	研發雙頭，四頭(多頭)劃線機、切割機、鑽孔機、雕刻機，提高產能效率。
手持式二維雕刻機	現今的所有成品或半成品都已漸漸開始注重產品的身份證明，2D barcode 已趨於普及，由上游到下游都必須進行身份的驗證，預計研發輕巧的手持式二維雕刻機，運用層面可廣及所有產業。

【2】預計再投入之研發費用：

本公司未來將持續投入產品研發，提高市場競爭力，預估 101 年度總研發經費約 25,000 仟元。

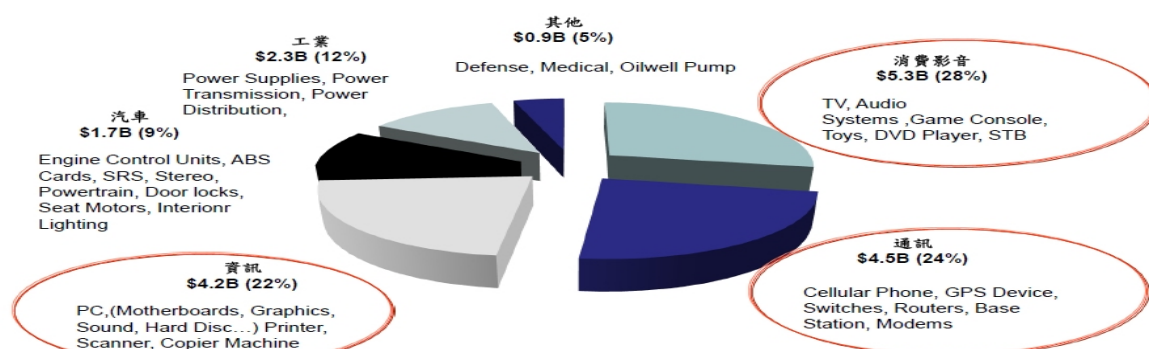
## (二)產業概況

### 1. 產業現況與發展

隨著各種電子產品朝多功能、低耗電及體積小等趨勢發展，為使電子產品能穩定工作，需藉由主動元件與被動元件的完美結合方能運作，目前被動元件生產，係以表面黏著技術(Surface-Mount Technology，以下簡稱 SMT)為主要生產方式，以被動元件生產廠商而言，SMT 生產方式及過程中所須設備與耗材更顯重要，透過 SMT 生產方式可提高生產效能，進而有效降低生產成本，同時可在節省電路之空間前提下，確保精密度及電路品質；另於 SMT 生產過程中，尚需有相關檢測儀器配合，以及時發現產品問題，避免製程中大量瑕疵品產生，而隨 SMT 生產檢測設備市場逐漸擴大，其應用領域亦相當廣泛，除用於電子產品之系統組裝，在電子元件製造及半導體、LCD 等不同領域均都有相當程度之接觸。

表面黏著元件(Surface-Mount Device，以下簡稱 SMD)產業係隨著表面黏著技術的發展而興起，取代了傳統 DIP 插件式零件，所佔據的空間微小，使產品設計更具彈性。由於 SMD 在製程上具高度自動化特性，所使用封裝材料品質除影響生產過程順利與否外，對 SMD 品質亦有極大影響，目前以日本製紙廠商所生產之精密紙帶及膠帶為主要材料，表面黏著元件主要應用領域包括主動元件、被動元件及機構元件等三大類，而雷科公司所供應之封裝材料則以被動元件為主。所謂被動元件係在電壓改變時，其電阻或阻抗不會隨之改變的元件，各種需要電力驅動的產品均需使用被動元件，其中以電阻器、電容器及電感器最為大宗，其下游應用範圍涵蓋 4C 產業(PC、消費電子、網通、汽車)及其他工業領域，且根據 Paumanok 研究發現全球被動元件市場仍以 3C 應用為主，隨著各種產品的電子化程度愈深，對被動元件的依賴程度也愈大。

全球被動元件市場之下游產品應用比重



資料來源：Paumanok(2011/4)

被動元件相較於 IC、顯示器或是電池...等相關零組件，雖然在電子系統產品中不是核心元件，但每項電子產品所需的被動元件數量，卻遠遠超過其他零組件所需之數量，而且被動元件所提供的電流/電壓控制、電能暫存、雜訊抑制/過濾...等功能，也是確保其他核心主動元件正常工作的必要保護。因此，被動元件雖然無法主導電子系統產品之發展，但其存在的必要性不言可喻，而被動元件終端應用產品的演進亦掌控著被動元件的需求與發展。

經由 IEK 調查結果顯示，智慧型手機、連網電視、平板電腦、無線通訊設備及 LED 等產品為被動元件發展最需密切關注之焦點，其中手機為被動元件最大應用產品，平板電腦為被動元件最新之應用產品，而智慧電視則是被動元件應用之潛力產品。而根據上述產品之共同特色，可看出運算環境、裝置型態及連網方式為三大重要改變，以運算環境而言，過去著重單機運算之模式，將隨著雲端運算之成熟而轉換至伺服器運算，使用者端的裝置將朝向更行動化作發展，所以連網的技術及設備也就更形重要，而伴隨此三大趨勢的改變，被動元件的產品設計也就必需朝更大量地使用、小型化、可靠度要求增加...等方向發展。

### 被動元件需求驅動



資料來源：IEK(2011/10)

因此，本公司 SMD 封裝材料及 SMT 設備產品之需求及發展實與智慧型手機、連網電視、平板電腦及個人電腦等終端產品之需求及發展息息相關。而本公司之 SMT 設備產品及雷射設備亦被大量使用在 3C 電子產品廠商之生產製程中，故亦受以下終端產品產業之影響。以下依本公司產品所應用之主要產業之現況分述如下：

#### 1. 行動裝置產業

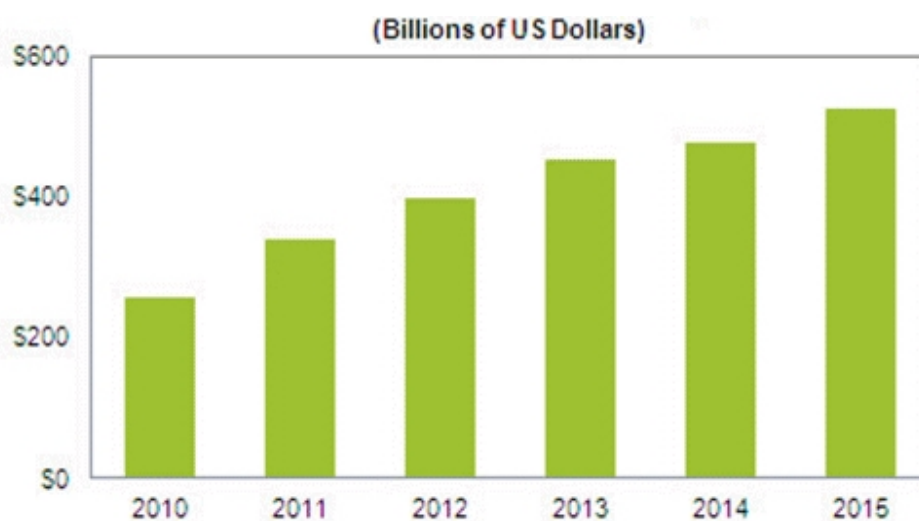
根據 IHS iSuppli 研究，2011 年全球行動通訊市場之廠商營收達到 3,408 億美元，預估 2012 年將可達 3,980 億美元，年成



長率達 17%，IHS iSuppli 所統計的行動通訊設備包含：智慧型手機、其他行動手機、平板裝置、無線基礎設備（例如：路由器）等。

雖然 2012 年的營收成長率情況不如 2011 年的 32% 暴增的那麼多，但是整體市場從不同角度來看，行動通訊設備於短期內仍沒有下降的跡象。因此，IHS iSuppli 預估 2013 年仍將又是兩位數的成長情況。長期來看至 2015 年時，行動通訊廠商營收將超過 5,000 億美元大關。而引領全球行動裝置成長的主要動能來自於智慧型行動裝置(包含智慧型手機、平板電腦、電腦產品)，以下將針對各別產品之展望分述如下：

全球行動通訊市場產值預估



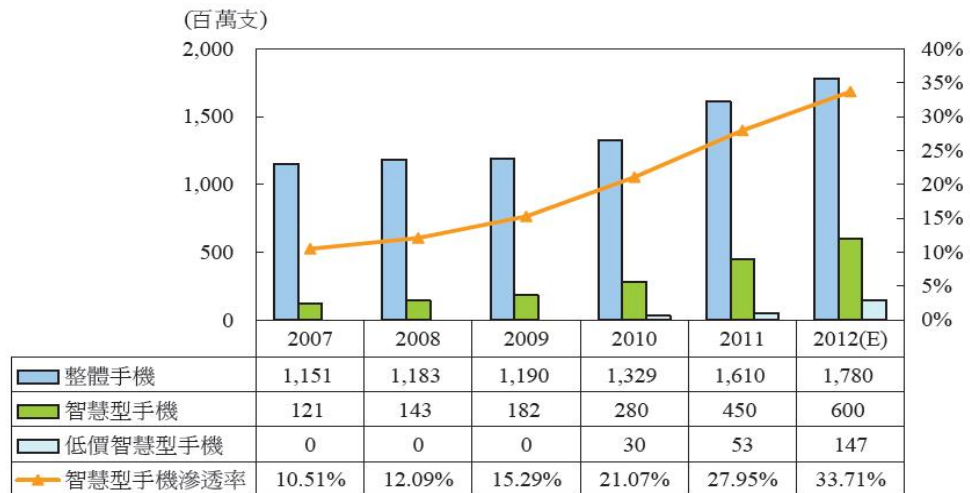
資料來源：IHS iSuppli，2011/11

#### (1) 智慧型手機

根據拓璞產業研究所調查，2011 年全球智慧型手機出貨量達 4.5 億支，滲透率達 27.95%，2012 年智慧型手機成長動能持續，在新興市場需求與平價化的帶動下，預估 2012 年成長至 6 億支，滲透率更進一步達到 33.71%，且以銷售值來看，由於智慧型手機單價為功能型手機之 4 至 5 倍，故使得智慧型手機銷售值佔整體手機銷售值的 57%。其中亞太區已成為全球最大的智慧型手機市場，隨著中國大陸與印度人民所得拉高，以及當地 3G 網路佈建逐漸普及，將催生消費者對手機進一步的功能需求，因此兩個新興市場以低價智慧型手機為市場主流。



2007~2012 年全球智慧型手機滲透率預估



Source：拓墣產業研究所，2012/02

展望 2012 年，在低階智慧型手機興起後，因品牌大廠本身產能有限，且低階產品毛利較低，品牌大廠將加速對外釋出低階智慧型手機代工訂單，代工廠則要以量取勝才能達到經濟規模。而台灣代工廠如華寶、華冠、富士康等，將可在品牌大廠擴大委外釋出低階智慧型手機代工訂單中獲利，因此平價智慧型手機將成為台灣手機代工廠未來的主要代工機種，並將有助於提高產品單價與利潤。台灣品牌廠商亦將受惠平價智慧型手機成長，帶動銷售量提高，預期 2012 年台廠整體手機出貨量達 1.28 億支。

## (2) 平板電腦

2011 年在 iPad 成功訂價與完整的服務模式帶領下，讓平板電腦的成熟度成為僅次於智慧型手機的行動上網裝置，展望 2012 年平板電腦出貨狀況，工研院 IEK 預估，2012 年全球平板電腦出貨將以純 Wi-Fi 的機種佔多數，約 60% 左右。就品牌而言，根據 Gartner 的研究顯示，微軟的 Windows 8 平板將會於 2012 年底之前推出，甚至亞馬遜的 Kindle Fire 新機種也將陸續報到，以及谷歌品牌的媒體平板也於 2012 年下半年上市，這些都將帶動非蘋果系列平板電腦出貨量之增長，但蘋果 iPad 仍將維持 2012 年全球媒體平板市場霸主之地位，預估 2012 年市場佔有率上看 61.4%。Gartner 預估 2012 年平板電腦出貨量達到 1.18 億台，年成長率約 98%，到 2016 年出貨量更可達到 3.69 億台。

### 不同作業系統媒體平板出貨量之預測

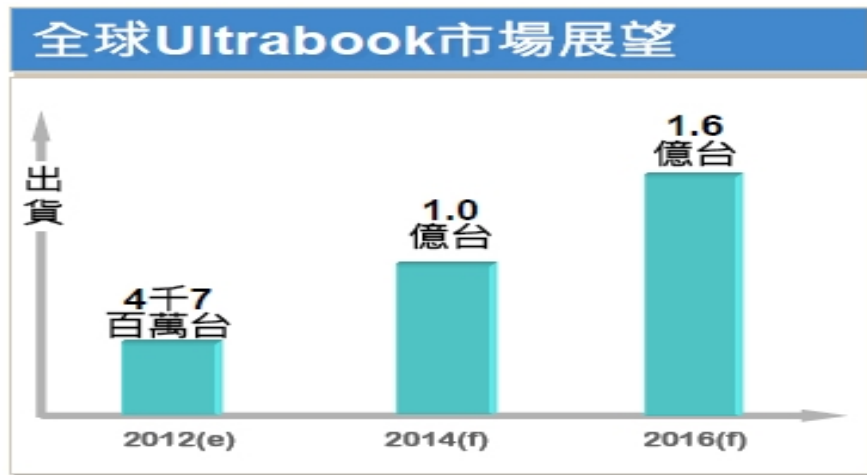
單位：千台

作業系統	2011	2012	2013	2016
iOS	39,998	72,988	99,553	169,652
Android	17,292	37,878	61,684	137,657
Micr osoft	0	4,863	14,547	43,648
QNX	807	2,643	6,036	17,836
Other Operating Systems	1,919	510	637	464
<b>Total Market</b>	<b>60,017</b>	<b>118,883</b>	<b>182,457</b>	<b>369,258</b>

資料來源：Gartner，2012/4

### (3)超薄筆電(Ultrabook PC)

筆記型電腦面臨平板電腦衝擊，電腦系統行動化促使 Intel 考量現今銷貨者需求，提出 Ultrabook 概念，藉以改變消費者使用 NB 的經驗。輕薄筆電的創始來自於 Apple 設計製造之 MacBook Air 產品，MacBook Air 於 2008 年推出之時，因單價過高，致其消費族群仍僅限於少數族群，隨著零組件技術的成熟，產品價格降低，以及 Apple 產品火紅產生的光暈效應，促使 Apple MacBook 全系列產品出現將近 40% 之高度成長。Apple 筆電產品的成功以及平板電腦的威脅刺激 Ultrabook 的誕生，Ultrabook 特別強調效能比以往之筆電產品更強，強調快速開機、耗電量低、系統抗震能力增加及散熱佳等特點，均針對行動便利性而來，再搭配 Windows 8 的上市，若 Ultrabook 售價能壓低在 700 美元左右，對於慣用 Windows office 系統之電腦使用者將具有極大的誘因，根據 IEK 估計 2012 年全球 Ultrabook 出貨量達到 4,700 萬台，2012~2016 年間將成長 200% 以上，至 2016 年出貨量將可達到 1.6 億台。由於台灣在個人電腦產業領域具有深厚實力，擁有許多重要關鍵零組件，Ultrabook PC 市場興起，對台灣 PC 供應鏈具有轉機發展的意涵。



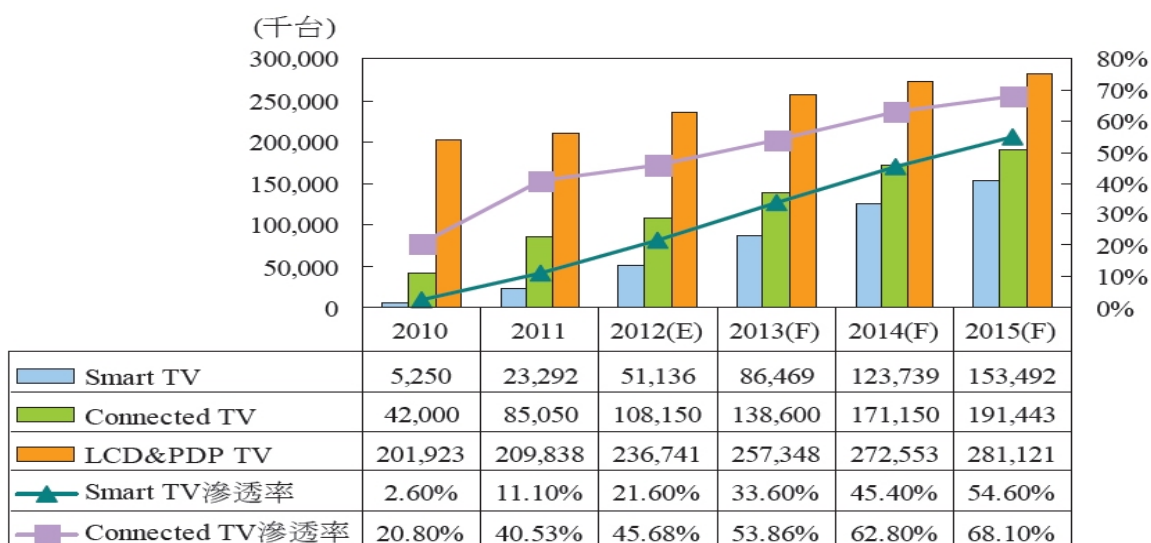
資

資料來源：IEK，2012/2

## 2.連網電視

連網電視市場趨勢走向 2 種分歧化發展，一種是內建高階電視播放服務(如 Hbb.TV、YouView)之基礎機種，另一種則為可設定應用程式、執行搜尋與瀏覽功能，並內建使用者介面之智慧電視(Smart TV)。近幾年來電視產品跨越了僅僅是硬體技術上的轉變，正式邁向內容應用的創新階段，讓電視產業迎向跨越性的挑戰，2010 年下半年智慧電視(Smart TV)開始正式出貨，除了 TV 本身具 Internet 功能之外，還在 TV 裡內建開放性作業平台，且具有電視用的應用商店，可視為連網電視(Connected TV)的進階版，拓璞產業研究所預估 2012 年智慧電視(Smart TV)佔整體平面電視的滲透率將大幅提升至 20% 以上，其內容與服務的差異化，提供可以整合服務的電視成為焦點，且伴隨著消費者接受度逐漸提高、供應端持續出貨，預估 2015 年滲透率將超越 50%。另就出貨量成長率來看 2012 年全球連網電視及 Smart TV 預估將分別出貨 1.08 億台及 0.51 億台，年成長率分別達 27% 及 120%，而至 2015 年全球連網電視及 Smart TV 出貨量將較 2012 年呈現倍數的成長，出貨量將分別達約 2 億台及 1.53 億台之水準。

## 2010~2015 年全球連網電視及 Smart TV 出貨量及滲透率

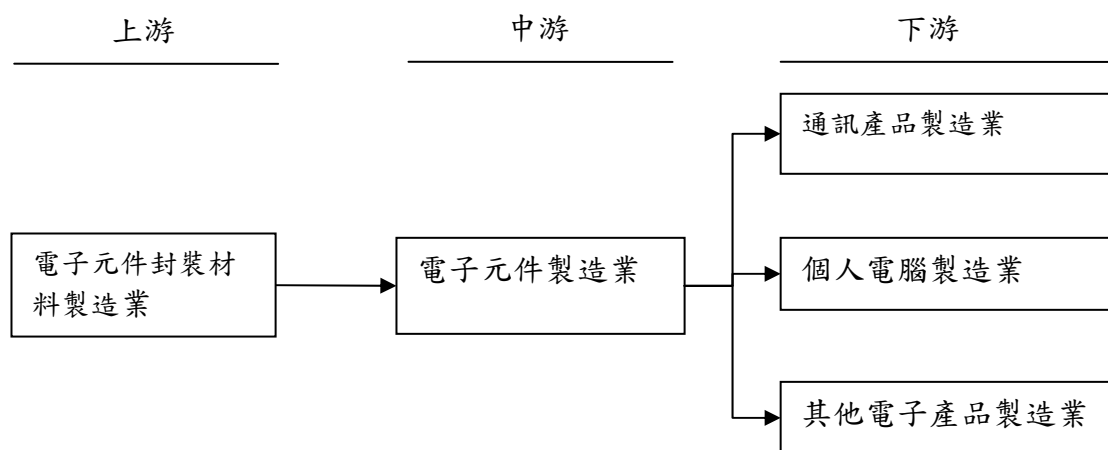


Source：拓璞產業研究所，2012/03

### 2. 產業上、中、下游之關聯性

#### (1)SMD 封裝材料

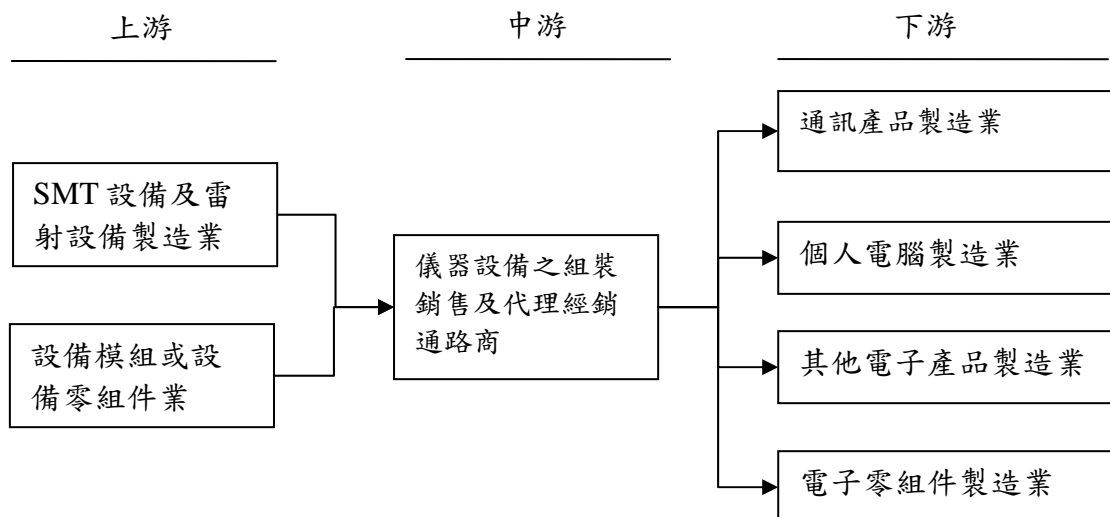
本公司於封裝材料產品部分，主要係 SMD 封裝材料之加工及銷售廠商，位處 3C 電子零組件產業中游之位置，上游為紙帶、膠帶及塑膠材料供應商，下游則為電子零組件製造商，茲將本公司所處產業之上、中、下游關聯性圖示如下：



資料來源：台灣趨勢研究及本公司提供

#### (2)SMT 設備及鐳射設備

本公司於設備產品部分，主要係 SMT 設備銷售代理及雷射設備之組裝銷售廠商，位處 3C 電子產品產業上、中游之位置，上游為 SMT 設備及鐳射設備模組或零組件供應商，下游則為 3C 電子產品及相關零組件製造商，茲將本公司所處產業之上、中、下游關聯性圖示如下：



資料來源：本公司提供

### 3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

#### (1) 產品小型化、薄型化

由於電子產品朝小型化、可攜帶化發展且以輕、薄、短、小與多功能為基本訴求，連帶使得電子產品之零組件小型化亦成為時勢所趨，體積較傳統固定電阻器小之表面黏著元件(Surface Mount Device, SMD)配合表面黏著技術(Surface Mount Technology, SMT)之普及將廣泛地應用於全自動化製程上，在此一市場趨勢下，產品精密度及複雜性高之表面黏著式之電子元件，由於其廣泛應用於資訊、通訊等高附加價值產業中，將持續成為市場發展之主流。

#### (2) 發展小尺寸之產品

電子元件小型化是市場之趨勢，小於0.01ohm-cm之SMD與ALD已陸續推出，另外在電子產品數位化及智慧化趨勢下，代表高精密度之電子元件及製程及檢測設備是未來發展重點，而小尺寸之SMD封裝材料及符合小尺寸規格之製程及檢測設備也是未來產品開發之方向。

#### (3) 可靠度增加、穩定的品質是需求的重點

SMD封裝材料產品單價低廉，對其下游電子元件廠商而言，封裝材料品質之穩定遠重於成本的降低，目前台灣封裝材料之生產技術已達世界水準，封裝材料品質已獲得客戶之肯定，應可在國際市場上與日本產品一爭長短。

就上述行業未來發展趨勢觀之，表面黏著元件封裝材料及表面黏著技術設備製造商能否持續推出應用於符合市場潮流之產品，將成為該業者能否在競爭市場上取得優勢之關鍵因素仍領先其他同業。

### (三)技術及研發概況

#### 1. 所營業務之技術層次

##### (1) SMD 封裝材料

被動元件產業用之晶片封裝上、下膠帶及紙帶原料供應與紙帶分條，以往在國內全仰賴由日本進口，本公司為提高附加價值層次，自日本進口全自動紙帶20 錘分條纏繞機及分條打孔纏繞機，使生產效率比單機提高20 倍，同時也購自日本全自動78 錘的膠帶分條機，提高膠帶分條生產率。

紙帶捲取機採用微晶片技術，具有同心圓捲取功能，可使紙帶平面度控制在1mm 以下，捲取品質更佳，並研發分條刀模之設計與改良，發展分條機汙點偵測影像系統。

本公司紙帶打孔技術已進化到0201 規格，且成功研發兩倍速度紙帶打孔專用機，發展打孔加工製程的機台E 值定位機構，減少E 值不良率，降低客訴。在打孔品質方面，市場上常因方孔直角度不佳或產生毛邊造成晶片包不順或P&P 吸料不順，本方公獨自研發出高溫毛邊燒除技術，並已成功應用於tape 加工製程，可提供客戶更高品質之無毛邊tape。以外也自行研發沖孔模設計改良，封下膠機構與現行打孔機連線及封帶，以提高產品附加價值。

本公司另有以塑膠原材製成之元件封裝載帶，此類載帶適用於各種元件封裝，如電容電阻、可變電阻器、IC、LED、繞線型晶片電感、電晶體、半導體等，材質可分PC、PS、PET 等塑膠原料，主要提供給半導體、LED 產業適用，本公司主要技術是自行研發品質良好、特殊規格之模具，以提供客戶客製化服務，此外，本公司也研發成功較高速度之成型機種，以提高產能，維持供貨之穩定性。

##### (2) SMT 雷射機器設備

本公司台灣廠及新加坡廠研發生產製造之SMT (Surface Mount Technology) 表面黏著技術設備以「Laser Tek」自創品牌行銷，研發製造各項應用雷射設備機，雷射機器設備除厚膜精密雷射切割調阻機、阻值量測機與薄膜精密雷射切割調阻機業均已研發自製完成行銷，並也成功開發新型雷射設備外，本公司也成功開發微電阻0201 雷射切割專用機、陶瓷基板畫線加工機、FPC 軟性PCB 之外型雷射切割機、SMT STENCIL 鋼板切割機、01005 UV 雷射畫線專用機等各種雷射應用機型，在雷射應用領域內，本公司仍持續投入研發更新型、更廣泛的雷射應用設備機。

## 2. 最近年度研發計畫與支出

100 年度投入研發之技術與產品：

年度	100 年	截至 101 年 4 月止
開發成功技術與產品	(1)01005 二代紫外光雷射切割機。 (2)高速全自動 Wafer 雷射雕刻機。 (3) 龍門 STENCIL 銅板切割機。 (4) 二代橋式 FPC 軟性 PCB 之外型雷射切割機。 (5) 整流二極體晶圓雷射切割機 (6) 精密雷射頻率修整機。	被動元件產業用薄膜晶片電感綠光開蓋機

最近年度研究發展支出

單位：新台幣仟元

年度	100 年度	截至 101 年 4 月止
研究發展費用	17,156	6,858

## 3. 計畫開發產品項目：

產品名稱	內容
Uv微盲孔鑽孔機	因應多層軟性電路板高密度內部微連結製程的需要，在銅箔上需要精密的微盲孔或穿孔的快速加工方案，此技術目前只有美國廠商ESI單一廠商能夠做到，因此我部門開始進行研發更高效率的新款機型。
IR鐳射焊接機	現今的智慧手機為提高更好的品質，會在原PCB板上再焊上一個鐵製遮蔽盒，目的在保護內部元件不受外界干擾，能更順暢的運作，焊接鐵盒必須仰賴人工操作，開始著手研發自動化鐳射焊接機來取代人工作業，目前實驗階段已接近完成。
IR鐳射除圍膠機	BGA返修過程，摘除BGA時的人工作業，非常容易導致報廢，藉此研發雷射除圍膠機，用鐳射非接觸式的方式先將固定膠劃出一道深溝，如此摘除BGA，可減少報廢率更可提高產能，目前相關部件已進入採購階段。
Green鐳射電感鑽孔機	將green鐳射導入0201電感鑽孔製程，目前已完成實驗階段，待軟硬體整合後即可完成。
Ball Screw劃線機	開發滾珠螺桿劃線機，將可提升劃線速度20%，目前已完成硬體結構，要提升至最高速的極限，軟體仍待測試。
雷射頻率修整機	精密雷射頻率修整機，以修整石英振盪器頻率為主。
Robot 機械臂	導入三軸 robot 機械臂取代傳統流道應用。
多頭鐳射應用	研發雙頭，四頭(多頭)劃線機、切割機、鑽孔機、雕刻機，提高產能效率。
手持式二維雕刻機	現今的所有成品或半成品都已漸漸開始注重產品的身份證明，2D barcode 已趨於普及，由上游到下游都必須進行身份的驗證，預計研發輕巧的手持式二維雕刻機，運用層面可廣及所有產業。



#### 4. 預計再投入之研發費用：

本公司未來將持續投入產品研發，提高市場競爭力，預估 101 年度總研發經費約 25,000 仟元。

#### (四)長、短期業務發展計畫：

##### 1. 短期業務發展計畫：

###### A. 持續擴大各產品線銷售

本公司一向以客戶需求為發展中心，希望能提供客戶更完整的產品。本公司在 SMD 捲裝材料產品類別內，同時提供被動元件產業、半導體及 LED 等產業所需求之元件捲裝材料，提供適合各項元件之不同需求。本公司銷售製造產品除 SMD 捲裝材料外，另一大類則為設備產品，在銷售代理 SMT 設備產品方面，本公司將持續擴增開發更多代理設備，以提供客戶全產品服務。在雷射設備產品方面，本公司持續研發製造各類應用之雷射機台，以滿足客戶的不同需求。

###### B. 持續研發鐳射機器設備應用

鐳射機器應用已在台灣廠及新加坡廠同時以 Laser Tek 做為研究發展、生產製造、行銷的領導品牌，目前已具成效。100 年已研發完成 IR 雷射陶瓷基板鑽孔機、整流二極體晶圓雷射切割機以及龍門型 SMT STENCIL 鋼板切割機等設備，預計 101 年除持續研發改良提高原有機型良率與技術外，也將同時進行多項雷射機型研發，並推出相關雷射機台。

###### C. 開發與整合能源事業

順應全球提倡節能減碳需求，除在電子產業努力耕耘外，本公司也因應市場需求，掌握最佳契機，並發揮本公司通路銷售優勢，開始積極開發 LED 燈具及節能空調銷售市場，期盼能推廣節能減碳的生活，為環境盡一份心力，也為本公司開拓更多元化的營運市場。

##### 2. 長期業務發展計畫：

A. 繼續朝建立「LASER TEK」全球 SMT 供應鏈最大供應商品牌的願景邁進，以雙核心策略攻勢，佈局材料業務(SMD)與設備製造(SMT)等兩大面向的發展，積極進位至全球市佔率 OVER 50%的領導品牌與高度。

B. 發展同心圓策略：以客戶為發展中心，在資源有限的情況下，周邊的輔助產業或次產業應積極扮演更專業的輔助角色，本公司將努力朝向成為全球第一 SMT 解決方案的供應商。



- C. 繼續積極投入發展研發各種不同之相關 SMT 相關應用之利基型機器設備產品，加大雷射應用之深度與廣度，對各種可以使用雷射取代之應用進行研發，以期將產品多樣化與客製化，開發藍海市場，成為公司將來獲利之利器。
- D. 深植人力培育計畫，以佈局全球行銷為目標，強化公司人力資源，提高產品質量管控與客戶售後服務，成功建構全球 SMT(表面黏著技術製程)最大供應能力與效益。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1. 主要產品銷售地區及市場佔有率：

單位：新台幣仟元

年度 銷售地區		99 年度		100 年度	
		營收淨額	佔營收淨額比率(%)	營收淨額	佔營收淨額比率(%)
內銷		532,168	46.54	508,993	40.56
外銷	亞洲	505,661	82.7	676,123	90.64
	美洲	83,612	13.68	38,167	5.12
	歐洲	18,038	2.95	27,265	3.66
	非洲	4,044	0.66	4,397	0.58
	小計	611,355	53.46	745,952	59.44
銷貨收入淨額		1,143,523	100.00	1,254,945	100.00

本公司主要從事SMD封裝材料、SMT設備代理銷售與雷射設備加工製造及銷售等業務，以我國目前產業發展言，表面黏著元件以被動元件發展最為蓬勃，本公司以國巨等國內被動元件大廠為主要銷售對象，目前國內與本公司從事相同業務僅有台灣電材、日東電工及瑋鋒等三家公司。另SMT設備，本公司主係從事代理銷售Cyber Optics生產之SMT製程設備，銷售對象為國內知名電子大廠，而SMT鐳射設備主係銷售厚膜雷射調阻機至台灣、大陸及東南亞等地區。

本公司對產品品質要求嚴格，長期以來致力於提高SMT鐳射設備之產品應用功能，並提供客戶一系列之解決方案，在整個SMT的製程中SMD材料、鐳射設備及SMT檢測儀器，均可提供一次購足(One-Stop Shopping)的服務，由於本公司品質穩定，產品深受市場認同，加上在積極拓展亞洲及非洲等海外市場下，100年度外銷比重由99年度之53.46%增至59.44%。

## 2. 市場未來之供需狀況與成長性

### (1) 供給面

近年來隨著智慧行動通訊興起，多媒體應用領域擴大，以及世界各國積極推動資訊化基礎建設並開發通信市場，帶動了全球行動裝置等資訊、通訊產品及其週邊產業蓬勃發展。而被動元件是電子產品中必要之關鍵零組件，隨著全球資訊及通訊市場規模持續擴大，預計對被動元件之需求量亦將持續增加。近年來，台灣資訊電子業憑藉優秀之高科技人才、技術與國內充沛之資金以及上、中、下游健全之產業結構，已成為全球資訊電子產品之製造中心，未來隨著台灣資訊及通訊產業蓬勃發展，將可提供國內被動元件產業極佳之發展機會。

SMT技術為電子產品微小化之生產製程中不可或缺的元素，SMT設備及鐳射設備則隨終端應用產品之發展，預期其需求亦將隨之成長。

### (2) 需求面

被動電子元件產業應用市場相當廣泛，舉凡所有電子產品幾乎均需用到被動電子元件，其應用市場主要可區分為資訊、通訊及消費性電子等三大領域，2012年預計有Ultrabook、智慧型手機與平板電腦陸續上架，下半年可望受惠於Window8於推出，預估我國被動元件產值年增率約2.85%。

本公司設備產品亦是隨著被動元件、智慧型手機、個人電腦及連網電視終端應用產品製造商產能擴充帶動增加資本支出計畫，而隨之產生設備需求，故從上述所提及全球智慧行動智慧裝置之供給未來將大幅成長，至2016年成長幅度可達100%，因此未來各智慧型產品供應商設備需求之動能可期。

### (3) 未來成長性

由於每個電子產品所需被動元件之數量不一，以手機為例，目前智慧型手機由於功能眾多，包括基頻模組、顯示驅動IC、觸控IC、記憶體、Sensor…等五大基本功能，再加上PAM、相機模組、MP4、WiF…等其它功能，一隻智慧型手機平均至少需要約900顆被動元件，至於功能型手機也需約450顆左右，因此2011年整體手機之被動元件需求量約為9,450億顆。IEK預估2012年整體手機之被動元件需求量將成長至11,620億顆，成長22.96%，以此推估，預計2012年被動元件之成長率將高於手機及筆記型電腦產品，顯示下游3C電子產業之蓬勃發展亦將帶動相關元件與設備未來之需求。

### 3. 競爭利基：

#### (1) 優異之經營團隊

本公司經營團隊具有優異之經驗與技術，對於關鍵性技術、產品品質以及市場脈動均能有效掌握。本公司主要經營者對於被動元件相關產業及雷射設備產業均具有相當的專業素養，且擁有多年被動元件產業及雷射設備產業的豐富經驗，所挑選之研發及技術支援人員更對被動元件產業及雷射設備產業專業知識及市場趨勢有充分之瞭解，其所組成陣容堅強之經營團隊係本公司立足於被動元件產業及雷射設備產業之根基。

#### (2) 擁有核心之技術平台

本公司擁有鐳射應用設備機台自行研發及組裝之專業技術能力，且能提供對客戶客製化的研發設計，在客戶產品開發及規劃期間能適時提供技術及產品上之支援，在功能上更能貼近客戶之需求，並在產品設計上更易於進行改善計畫，使得本公司之專業技術得以維持國際級之水準。

#### (3) 完整及穩定之設備產品代理線

本公司與世界知名大廠 Cyber Optics、Dek 及 Cyber TECH 等主要供應商均維持良好合作關係，提供客戶多元化之設備產品，如：錫膏測厚儀、AOI 自動光學檢查系統、鐳射非接觸掃描儀及 SMT 印刷設備等設備產品，配合台灣設備供應商之產品，如：錫焊爐等，再加上本公司自行組裝之鐳射設備，使產品組合幾乎能涵蓋 SMT 全製程。另本公司與各主要供應原廠均合作多年，其所代理設備產品之來源穩定性亦無庸置疑。故本公司所取得代理權之穩定性及多元化為本公司未來發展奠定穩固之基礎。

#### (4) 自有品牌建立與多樣化產品

本公司在 SMD 封裝材料之產品包括上下膠帶、紙帶與打孔紙帶等，並採取共同搭配銷售方式，提供客戶一次購足的服務，減少下游客戶作業成本，此外，本公司產品線尚包括 SMT 生產線上多樣設備之代理買賣，以及本公司鐳射設備產品以「LASER TEK」品牌行銷全球，從自行研發行銷以來，業績大幅成長及接獲許多國內外客戶訂單顯示本公司品牌及形象建立相當成功，且本公司積極開發各式產品，開發多樣化產品，以滿足客戶一次購足之需求，進而提高本公司之市場佔有率。

### 4. 發展遠景之有利及不利因素

#### (1) 有利因素：

##### A. 全球資訊及通訊市場蓬勃發展

近年來隨著智慧行動通訊興起，多媒體應用領域擴大，以及世界各國積極推動資訊化基礎建設並開發通信市場，帶動了全球行動裝置等資訊、通訊產品及其週邊產業蓬勃

發展。而被動元件是電子產品中必要之關鍵零組件，隨著全球資訊及通訊市場規模持續擴大，預計對被動元件之需求量亦將持續增加。近年來，台灣資訊電子業憑藉優秀之高科技人才、技術與國內充沛之資金以及上、中、下游健全之產業結構，已成為全球資訊電子產品之製造中心，未來隨著台灣資訊及通訊產業蓬勃發展，將可提供國內被動元件產業極佳之發展機會。

SMT 技術為電子產品微小化之生產製程中不可或缺的元素，SMT 設備及鐳射設備則隨終端應用產品之發展，預期其需求亦將隨之成長。

B. 中國大陸物價高漲，帶動人工成本上漲

中國大陸近幾年來發展迅速，經濟熱絡伴隨著物價高漲，民生物資等生活成本逐步提升，再加上歐美市場經濟景氣不振影響之下，中國政府為維持經濟高速成長，加速發展中國國內內需市場，中國政府為提振國內民眾消費購買力，不斷調升勞工基本工資，導致身為世界工廠之中國大陸地區人工成本不斷上漲。本公司封裝材料之生產自動化程度極高，產線所需人力有限，故較不受人工成本漲價之影響，而設備產品則受益於人工成本漲價之影響，自動化設備需求大增，SMT 設備及雷射設備銷售於近幾年大幅成長，未來本公司設備產品出貨量將隨著 SMT 廠商製程逐步提高產線自動化程度而逐步增長。

C. 下游被動元件生產版圖移動，台灣廠商訂單增加

在歷經2011年日本311大地震、福島核能危機及其所造成之電力供應不足之影響，日本大廠營運虧損嚴重，產能擴充腳步趨於緩慢，部分廠商並將生產線逐漸移往台灣，加上面臨日圓匯率走升壓力，使得日系被動元件廠毛利不斷被壓縮，日系產品競爭力下降，客戶基於採購成本考量下，轉單給日本以外之被動元件廠，台灣被動元件、封裝材料及相關製程設備廠商都將因此而受惠。

D. 跨足多種產業，產品類型多

本公司銷售產品跨足多種電子產業類型，不受單一產業景氣循環的影響，且本公司憑藉擁有多項產品的優勢與研發的技術，除了產業市場可以互相結合外，也可以滿足客戶單一或全面的需求，本公司除了自製研發的設備機台有多重的應用外，提供銷售代理設備業務，也代理多家知名品牌的設備，提供各客戶不同的需求。

(2) 不利因素：

A. SMD封裝材料價格競爭漸趨激烈

大陸封裝材料製造商因自行研發封裝材料所需原材，因此可以提供價格較日本原材低廉的封裝材料，雖品質仍差，但已改變SMD封裝材料市場產品價格競爭結構，未來

封裝材料之產品價格將日趨激烈。

因應措施：

大陸廠商之 SMD 封裝材料雖然價格較具優勢，但其產品品質仍然較為劣質，故目前市場接受度仍低，惟本公司近年仍積極持續尋找其他價格較低的原材來源，目前已有部份韓國供應之原材可以取代日本較高單價的原材，未來除了日韓供應商外，將會與其他供應商開發品質更好、價格更低廉的原材，以與大陸廠商競爭。此外，本公司也積極更新自動化生產設備，研發相關的加工技術，降低生產成本，以具競爭力的價格及優良的品質取得客戶的信賴。

B. 部份重要原材料須由國外進口

本公司產品所用部份重要原材料—紙帶原材仍由國外廠商所控制，目前紙帶原材之市場主要仍由日本等大廠掌握，一旦市場供應失調，易導致價格劇烈變動與供貨不足等情形。

因應措施：

本公司目前除與原有日本主要供應廠商，維持良好及長期合作關係外，已與韓國製紙廠商於 97 年度開始合作至今，適度調整採購來源並分散不同進貨廠商，以避免進貨過於集中少數廠商，以降低營運風險，未來將積極尋求與其他地區之紙帶原材供應商策略聯盟，使紙帶原材之掌握度能進一步提高，以減少對外之依賴度。

C. 電子元件價格下降

隨著電子產品價格持續走低，電子元件之售價亦一路下跌，加以日本廠商紛紛壓低價格以維持市場佔有率，亦導致電子元件產品售價下跌。在下游產品壓低價格下，勢必對封裝材料等上游供應商降低採購成本，降低採購價格。

因應措施：

本公司不斷地改善生產製程以提高產能利用率及產品良率，並積極擴大生產規模、改良自動化生產設備及增加營運效率，以降低生產及營運成本，另外本公司產品在國內僅有少數廠商供應，且為其中生產規模較大者，故本公司擁有規模經濟之成本優勢，而在國際市場上較其他國家廠商之產品擁有極具競爭力之價格，並配合產製設備之組合銷售，擴大服務之層面，提高服務之品質，以維持本公司產品合理之利潤。

## (二)主要產品之重要用途及產製過程

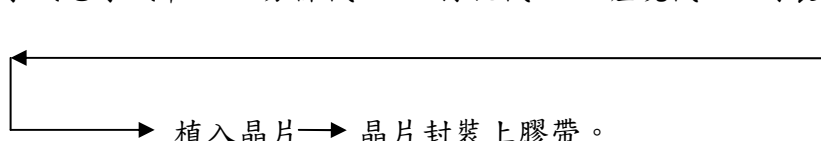
### 1. 主要產品之用途

產業	產(商)品項目	服 務 項 目
SMD 產 業 相 關 產 品	晶片封裝膠帶、紙帶	SMD LED (藍光、白光發光二極體)、SMD 電晶體、SMD 二極體的突波抑制器 (TVS)、蕭特基體 (Schottky)、標準整流二極體 (STD Rectifier)、快速整流器、(Fast Diode)、超快速二極體 (Ultra Fast)、SMD NTC Thermistor、SMD Varistor、電阻、電容、電感..等。
	半導體元件封裝載帶	適用於各種元件封裝，如電容電阻、可變電阻器、IC、LED、繞線型晶片電感、電晶體、半導體等，材質可分 PC、PSS、PET 等塑膠原料。
	包裝測試機	測試包裝機，乃為三機一體之設計，(包含打 孔 機、測試機、捲帶機)。適用於 SMD 元件(電阻、電 容、電感)之產品測試包裝，並將其元件測試完成後，包裝成帶收齊成捲。
	LED 自動包裝機	專為 SMD 元件(R, C, L, LED, Diode, Fuse, NTC)測試包裝所設計之機台，含多道外接電性測試擴充功能，測試完後包裝成帶，收齊成捲之功能。 產品特點： 完全自動化包裝、測包速度保證、主要零件鎢鋼防磨耗特殊設計、LED 防靜電設計、中英文操作介面、測試機可依照產品與客戶需求另加 CCD 外觀檢視選擇配備。
SMT 產 業 相 關 設 備	SE-300 全自動線上錫膏檢測機	1. 直接連結在 Printer 後，全自動 100%全檢，可量測 3D Height True Volume、Area & Bridge。 2. 可高速檢測的零件有：BGAs、Fine Pitch QFPs、CSPs、0402...etc。 3. 檢測速度可分成 High-speed & High-Resolution 二種模式，最快可測到 29.0 cm <sup>2</sup> /sec。 4. 檢測程式可輸入 Gerber data、BOM、Assembly Drawings、CAD XY data...etc，將其轉成 SE-300 使用的程式，使程式製作容易。
	FlexUltra HR AOI 自動光學檢查系統	1. In Line 放置在迴焊爐(Reflow)前後，檢測置件機良率及迴焊後零件狀態。 2. 可檢測零件是否缺件、極性、歪斜、焊點品質、零件腳彎、字元及 Logo 辨識..etc。 3. SAM(Statistical Appearance Modeling)。 4. CAD x-y、BOM 輸入轉換成檢測程式，程式教導容易。 5. 提供檢測零件影像導覽及不良分析報告，迅速掌握不良品，並提供資料給 Rework Center，降低 ICT Test Cost。 6. SPC KAnalysis Application-Web Accessible HTML Charts。 7. 提早發現不良並找出置件製程的變異。 8. 高解析度影像擷取，能檢查所有零件種類，目前能檢測 0201/01005 零件。 9. 可與 SE300 Ultra 錫膏檢查機共享資料，提供 SMT 製程資料追蹤。
	V50 鐳射非接觸剖面掃描儀	1. 2D 非接觸式掃描系統 適用於厚膜印刷，混成電路(Hybrid Circuit), BGA, TAB 及 FLIP/CHIP, SOLDER BUMPING 厚度量測, SMT 印刷錫膏量測。 2. 鐳射非接觸式量測，乾膜及濕膜皆可量測。 3. 0.125um 動態高解析度，量測精度達 1um。
	雷射修阻機 1. IR 激光修阻機 2. Green 雷射修阻機 3. 功能性修阻機 飛快式探測儀	1. 被動元件、電阻阻值雷射修整。 2. SMT 製程功能性切割，如：VCO、POWER SUPPLY、LTCC 等切割。 3. 高速 200PCS/秒，高精度±0.2%切割。 4. 在基板上快速且準確地量測阻抗值，同時可精算出調阻前與調阻後的數值，主要應用於調阻電阻以及混成微電子電路。
	全固態雷射雕刻機(氣冷式, 6 to 8 W) 全固態雷射雕刻機 (High-Power, 35 to 75 W)	1. 在雷射加工的應用環境中，提供雷射標誌及切割的全方位服務。 2. 以精準穩定的效率呈現，這來自於我們所擁有工藝美學的雷射光源—二極體激發式固態雷射。(Nd:YAG, Nd:GdVO4, Nd:YVO4)。
	FR4 PCB 硬版切割機	1. SMT 後成品之 PCB 外廓切割成型。 2. 解決傳統 ROUTER 刀模切割的準度與空間限制。 3. 具使用彈性對各種不同形狀的 PCB 作外型精密加工且不傷已 SMT 完的產品。 4. Fine pitch 高精度的加工提昇產品材料比。 5. APPLE I-PHONE 應用。 6. 搭配 CO2 LASER。

## 2. 主要產品之產製過程

晶片封裝上、下膠帶及紙帶：

原紙絕緣紙帶 → 分條機 → 打孔機 → 纏繞機 → 封裝下膠帶



主動元件封裝塑膠載帶：

膠粒 → 押出塑膠帶 → 分條機 → 成型 → 植入晶片 → 封裝上膠帶

雷射自製設備：

各項零件與雷射頭 → 組裝成型 → 軟體設計調整 → 測試 → 雷射設備

### (三) 主要原料之供應狀況：

主 要 原 料	主 要 供 應 商	供 應 狀 況
表面黏著元件封裝原材	JEF SHOJI、SANTOKU、 HANSOL	良 好

### (四) 最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額及比例，並說明其增減變動原因：

#### 1. 最近二年度任一年度中曾佔銷貨總額百分之十以上之客戶名稱：

本公司最近兩年度主要銷售客戶皆未達 10% 以上。

#### 2. 最近二年度任一年度中曾佔進貨總額百分之十以上之供應商名稱：

單位：新台幣仟元

	99 年度				100 年				截至 101 年 3 月 31 日			
	名稱	金額	占進貨淨額比率	與本公司之關係	名稱	金額	占進貨淨額比率	與本公司之關係	名稱	金額	占進貨淨額比率	與本公司之關係
1	CYBER OPTICS	171,844	19.31%	無	CYBER OPTICS	242,700	26.39%	無	振弘科技	33,768	20.70%	無
2	JFE SHOJI	120,579	13.55%	無	DTG	97,270	10.58%	無				
3	雷科國際	104,005	11.69%	孫公司								
	其他	493,363	55.45%	—	其他	579,804	55.45%	—	其他	129,373	79.30%	—
	進貨淨額	889,791	100.00%	—	進貨淨額	919,774	100.00%	—	進貨淨額	163,141	100.00%	—

CYBER OPTICS 為設備供應商，主係受惠於全球經濟景氣持續好轉，廣達集團在業績成長帶動下，對 SMT 設備需求量大幅增加，本公司對其採購金額亦隨之攀增，故最近二年度 CYBER OPTICS 均為最大供應商。另 100 年度 DTG 竄升為第二大進貨商，受惠富士康集團持續擴廠增加資本支出下，對設備需求量增加，對其採購金額亦隨之攀增。另本公司主係向雷科國際採購被動元件包裝用之上下膠帶，由於 100 年度因價格及客戶需求下降導致對雷科國際採購金額減少許多；JFE SHOJI 主係代理日本 DAIO PAPER 之紙帶，99 年度因全球經濟景氣回溫，帶動被動元件產業需求增加

，故向 JFE SHOJI 採購金額大幅成長；100 年下半年受歐債危機影響，歐美經濟景氣陷入衰退之疑慮，被動元件廠商縮減產能，採購金額遂向下修正。整體而言，本公司最近二年度主要供應商變化情形尚屬合理。

(五)最近二年度生產量值表：

單位：仟米；新台幣仟元

年度 主要產品	99 年度			100 年度		
	產能	產量	產值(註1)	產能	產量	產值(註1)
SMD 封裝材料	966,657	688,186	288,647	513,182	675,410	276,834
SMT 製品(註)	—	3	8,462	—	5	11,157
鐳射製品(註)	—	35	63,684	—	35	50,195
半導體設備	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	9,645	—	—	6,430
合計	966,657	—	370,438	513,182	—	344,616

註 1：列示製造產量與產值，不包含買賣進量與進值。

註 2：係空調委外加工與 LED 組裝產出金額。

(六)最近二年度銷售量值表：

單位：新台幣仟元

年度 項目	99 年度				100 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
SMD 封裝材料	869	278,344	4,029	216,004	589	208,618	1,265	175,001
SMT 製品	36	78,706	86	174,454	15	33,156	200	423,362
鐳射製品	6	18,604	37	153,948	20	84,767	3	16,700
半導體設備	6	51,433	4	37,939	5	43,481	3	33,552
其他	3,688	73,374	10,403	60,717	99,427	161,010	40,019	75,298
合計	—	500,461	—	643,062	—	531,032	—	723,913



三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比例。

單位：人

年 度		99 年度	100 年度	截至 4 月 30 日止
員工人數 (人)	間接人員	148	142	142
	直接人員	48	43	43
	合 計	196	185	185
平均年歲(歲)		37.1	38.05	36.68
平均服務年資(年)		3.43	3.85	4.58
學歷分佈 比率	博 士	-	-	-
	碩 士	8.67%	8.11%	8.11%
	大 專	37.25%	61.62%	61.08%
	高中以下	54.08%	30.27%	30.81%

四、環保支出資訊：最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償）及處分總額，並說明未來因應政策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實）。

- (1) 本公司主要從事表面黏著元件封裝用之上、下膠帶及紙帶加工製造，並導入 RoHS 規範要求，依法令規定非屬現階段水污染、空氣污染防治公告之事業種類，並無環境污染之虞。此外，本公司平時對於工廠週遭環境即予以妥善維持，且完全符合經濟部加工出口區管理處環保單位之要求。
- (2) 本公司最近兩年度及截至年報刊印日止並無環境污染之情事。

五、勞資關係

- (一) 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司一向秉持尊重員工、照顧員工、培育員工的信念，希望透過充實與安定員工生活的福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係，因而本公司員工皆能發揮團隊精神，配合公司政策，彼此合作無間，使勞資之間充滿和諧的氣氛。此外，本公司訂定員工行為守則，將員工服務應遵守之守則明定，使員工能確實遵行。以下是本公司致力於勞資和諧關係之具體措施：

1. 員工分紅

為使全體員工能同心協力、共創未來，依據營運結果估列一定比例之員工分紅費用。本公司一向秉持尊重員工、照顧員工、培育員工的信念，希望透過充實與安定員工生活的福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係。

2. 進修與教育訓練

進修與教育訓練是本公司培育員工一貫秉持的信念，因此由人力資源處及各部門主管共同擔負此責。從新進員工的新人訓練、專業技能訓練乃至管理階層訓練，期能培養出具有高度人文素養、專業素養及正確工作

價值觀的優秀人才。本公司相信，唯有持續且有計劃的進行人才培訓與投資並保持優勢的人力資源素養，才能使企業不斷的成長、茁壯。

依照 2011 年度教育訓練計劃，完成品質類課程教育訓練共 30 人次、統計類課程教育訓練共 20 人次、財務類課程教育訓練共 30 人次、其他專業類課程教育訓練共 20 人次、消防安全教育訓練共 40 人次，本公司均已達成以上規劃目標。

### 3. 溝通管道

本公司採人性化管理，為尊重員工，特別設有溝通座談會、意見箱、部門會議等多種溝通管道，供同仁與各級主管做單向或雙向的意見表達或溝通。

### 4. 福利委員會概況

福委會每年定期舉辦員工旅遊、部門聚餐、藝文講座…等活動。除此之外，尚有婚喪、生育、住院補助金。

### 5. 其他福利措施

社團活動：公司內所有的社團都為自發性召集同好所組成，並由福利委員會經費補助下定期或不定期舉辦文康活動。

保險：勞工保險、全民健康保險、公司團保。

### 6. 員工退休金

本公司為建立長遠和諧勞資關係，已訂立員工退休辦法，並申請成立職工退休準備金監督委員會，每月按已付薪資總額 6% 限度內提撥退休基金於中央信託局，凡合乎員工退休辦法規定條件之員工退休時，均得申請。

### 7. 勞資間之協議情形

本公司有關勞資關係之一切規定措施，均依照相關法令實施，故勞資關係良好，任何有關勞資關係之新增或修正措施，均經勞資雙方充分協議溝通後才定案，故無任何爭議發生。

**(二)列明最近年度及截至公開說明書刊印日止因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：**

1. 本公司向來重視勞資關係，因此未曾發生勞資糾紛，也未曾因勞資糾紛而遭受損失。

2. 目前及未來可能發生之估計損失與因應措施：

本公司目前及未來均將充分遵循勞工法令及加強福利措施，建立互動式之溝通及申訴管理。本公司之勞資關係向來理性和諧，近二年度並無勞資糾紛及損失發生，因此未來發生勞資糾紛之可能性極少。

## 六、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
土地租賃	經濟部加工出口區	100.01.01~109.12.31	土地租賃	無
土地租賃	經濟部加工出口區	100.08.01~105.07.31	土地租賃	無
中長期授信合約	兆豐國際商業銀行	101.02.20~104.02.20	中長期營運週轉使用	無

## 陸、財務概況

### 一、財務資料

#### (一)、簡明資產負債表及損益表

##### 1. 簡明資產負債表資料

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度		最近五年度財務資料(註)					當年度截至 101 年 3 月 31 日
		96 年度	97 年度	98 年度	99 年度	100 年度	
流動資產		864,665	408,152	687,776	1,211,597	1,166,329	1,220,778
基金及長期投資		1,181,230	1,325,142	1,371,730	1,482,619	1,594,066	1,561,407
固定資產		92,010	93,451	107,973	99,335	180,396	177,011
無形資產		—	—	—	—	—	—
其他資產		80,182	1,071	13,511	31,474	47,056	42,158
資產總額		2,218,087	1,827,816	2,180,990	2,825,025	2,987,847	3,001,354
流動負債	分配前	652,228	570,728	789,698	820,099	1,123,491	1,063,166
	分配後	873,205	589,155	872,028	966,808	尚未分配	尚未分配
長期負債		103,333	43,992	83,778	538,561	482,742	541,964
其他負債		204,746	229,002	172,665	182,719	85,188	85,942
負債總額	分配前	960,307	843,722	1,046,141	1,541,379	1,691,421	1,691,072
	分配後	1,181,284	862,149	1,128,471	1,688,088	尚未分配	尚未分配
股本		682,061	717,343	715,918	756,916	801,757	773,757
資本公積		178,902	178,902	174,700	298,609	276,561	269,843
保留盈餘	分配前	377,344	196,798	292,403	467,267	450,359	443,695
	分配後	121,085	160,668	174,277	320,558	尚未分配	尚未分配
金融商品未實現損益		15,584	(68,136)	(1,769)	(6,015)	(22,397)	(15,625)
累積換算調整數		3,889	36,123	(253)	(121,901)	(51,744)	(87,358)
未認列為退休金成本之淨損失		—	—	(993)	(1,056)	(2,900)	(2,900)
庫藏股票		—	(76,936)	(45,157)	(110,174)	(155,210)	(71,130)
股東權益總額	分配前	1,257,780	984,094	1,134,849	1,283,646	1,296,426	1,310,282
	分配後	1,036,803	965,667	1,052,519	1,136,937	尚未分配	尚未分配

註：最近五年度財務資料均經會計師查核簽證，101 年第一季財務資料係經會計師核閱。

## 2. 簡明損益表資料

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最近五年度財務資料(註 2)					當 年 度 截 至 3 月 3 1 日
	96 年度	97 年度	98 年度	99 年度	100 年度	
營 業 收 入	675,388	528,518	566,267	1,143,523	1,254,945	275,552
營 業 毛 利 ( 註 1 )	109,404	114,944	121,537	232,938	258,671	99,711
營 業 利 益	15,215	8,655	6,475	37,742	93,937	64,098
營業外收入及利益	413,321	126,663	96,427	247,418	97,523	7,636
營業外費用及損失	16,339	34,104	14,730	28,558	60,852	16,885
繼續營業部門稅前 純 益	412,197	101,214	88,172	256,602	130,608	54,849
繼續營業部門損益	280,042	75,713	135,977	292,990	209,190	44,600
停 業 部 門 損 益	—	—	—	—	—	—
非 常 損 益	—	—	—	—	—	—
會計原則變動之累 積 影 響 數	—	—	—	—	—	—
本 期 損 益	280,042	75,713	135,977	292,990	209,190	44,600
每 股 盈 餘 ( 元 )	4.11	1.06	1.95	3.92	2.60	0.59

註 1：營業毛利尚未加(減)聯屬公司間已(未)實現毛利。

註 2：最近五年度財務資料均經會計師查核簽證，101 年第一季財務資料係經會計師核閱。

## 3. 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	事務所名稱	會計師姓名	查核意見	備註
96	冠恆會計師事務所	張進德、萬益東	無保留意見	—
97	冠恆聯合會計師事務所	張進德、萬益東	修正式無保留意見	採用新財務會計準則公報。
98	資誠聯合會計師事務所	吳漢期、林億彰	修正式無保留意見	採用新財務會計準則公報。
99	資誠聯合會計師事務所	劉子猛、林億彰	無保留意見	—
99	資誠聯合會計師事務所	林億彰、王國華	無保留意見	—

註：因考量本公司業務與管理之需要，爰經董事會決議通過委請資誠聯合會計師事務所辦理98年上半年度起之簽證事宜。

## 二、最近五年度財務分析

分析項目		年度	最近五年度財務分析(註)					當年度截至3月31日
			96年度	97年度	98年度	99年度	100年度	
財務結構(%)	負債占資產比率		43.29	46.22	47.97	54.56	56.61	56.34
	長期資金占固定資產比率		1,479.31	1,100.13	1,128.64	1,834.41	986.26	1046.40
償債能力(%)	流動比率		132.57	71.87	87.09	147.74	103.81	114.82
	速動比率		121.64	56.95	71.27	128.12	88.62	99.05
	利息保障倍數		39.52	9.83	9.40	20.07	6.03	5.51
經營能力	應收款項週轉率(次)		2.58	2.04	2.18	3.09	3.37	2.95
	應收款項收現日數		141	179	167	118	108	124
	存貨週轉率(次)		9.76	6.88	4.82	6.32	6.03	4.34
	應付款項週轉率(次)		10.56	7.16	5.93	5.84	7.10	8.4
	平均銷貨日數		37	53	76	58	60	84
	固定資產週轉率(次)		7.34	5.66	5.24	11.51	8.97	6.17
	總資產週轉率(次)		0.30	0.29	0.26	0.40	0.43	0.37
獲利能力	資產報酬率(%)		14.42	4.31	7.18	12.15	7.94	6.80
	股東權益報酬率(%)		23.41	6.75	12.83	24.23	16.22	3.42
	占實收資本比率(%)	營業利益	2.23	1.82	0.65	4.99	11.72	8.28
		稅前純益	60.43	14.11	12.32	33.90	16.29	4.44
	純益率(%)		41.46	14.33	24.01	25.62	16.67	16.19
	每股盈餘(元)		4.11	1.06	1.95	3.92	2.60	0.59
現金流量	現金流量比率(%)		27.68	25.12	-	3.15	0.09	-
	現金流量允當比率(%)		55.25	45.80	35.58	19.73	0.53	-
	現金再投資比率(%)		1.32	-	-	-	-	-
槓桿度	營運槓桿度		5.00	9.73	18.57	8.30	10.54	4.30
	財務槓桿度		3.37	(3.08)	(0.80)	1.21	1.38	1.13

上表計算公式如下：

1. 財務結構

- (1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。
- (2) 長期資金占固定資產比率 = (股東權益淨額 + 長期負債) / 固定資產淨額。

2. 償債能力

- (1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債。
- (2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。
- (3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

3. 經營能力

- (1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
- (2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。
- (3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。
- (4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
- (5) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。
- (6) 固定資產週轉率 = 銷貨淨額 / 固定資產淨額。
- (7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 資產總額。

4. 獲利能力

- (1) 資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額。
- (2) 股東權益報酬率 = 稅後損益 / 平均股東權益淨額。
- (3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。
- (4) 每股盈餘 = (稅後淨利 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。(註 4)

5. 現金流量

- (1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。
- (2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。
- (3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 營運資金)。(註 5)

6. 槓桿度：

- (1) 營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益(註 6)。
- (2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

註 4：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：

- 1. 以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
- 2. 凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
- 3. 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
- 4. 若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註 5：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：

- 1. 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
- 2. 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
- 3. 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
- 4. 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
- 5. 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額。

註 6：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

### 三、監察人審查報告

## 雷科股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司及合併子公司 100 年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所林億彰、王國華會計師查核簽證竣事，連同營業報告書及盈餘分配表等表冊，業經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，備具報告書，報請 鑒核。此致

本公司 101 年股東常會

監察人：陳志祥

鄭玉慧

徐守德

中 華 民 國 一 〇 一 年 五 月 三 日

四、最近年度財務報表：本公司 100 年度財務報表請詳第 94 頁至第 142 頁

五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表：請詳第 143 頁至第 198 頁。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

## 柒、財務狀況、經營結果之檢討分析及風險事項評估

### 一、財務狀況

本公司最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目（前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者）之主要原因及其影響及未來因應計畫：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	100 年度	99 年度	差異	
			金額	%
流動資產	1,166,329	1,211,597	(45,268)	(3.74)
長期投資	1,594,066	1,482,619	111,447	7.52
固定資產	180,396	99,335	81,061	81.60
其他資產	47,056	31,474	15,582	49.51
資產總額	2,987,847	2,825,025	162,822	5.76
流動負債	1,123,491	820,099	303,392	36.99
長期負債	482,742	538,561	(55,819)	(10.36)
其他負債	85,188	182,719	(97,531)	(53.38)
負債總額	1,691,421	1,541,379	150,042	9.73
股本	801,757	756,916	44,841	5.92
資本公積	276,561	298,609	(22,048)	(7.38)
保留盈餘	450,359	467,267	(16,908)	(3.62)
累積換算調整數	(51,744)	(121,901)	70,157	(57.55)
未認列為退休金成本之淨損失	(2,900)	(1,056)	(1,844)	174.62
金融商品未實現損益	(22,397)	(6,015)	(16,382)	272.35
庫藏股票	(155,210)	(110,174)	(45,036)	40.88
股東權益總額	1,296,426	1,283,646	12,780	1.00
(一)變動原因及影響：				
一、 固定資產：主係本年度購置廠房所致。				
二、 其他資產：主係存出保證金增加所致。				
三、 流動負債：主係應付公司債屬一年內到期重分類所致。				
四、 長期負債：主係長期借款減少所致。				
五、 負債總額：主係短期借款與發行公司債增加所致。				
六、 累積換算調整數：主係受匯率變動影響，海外轉投資淨值差異造成累積換算調整數波動所致。				
七、 未認列為退休金成本之淨損失：主係依據精算師報告調整所致。				
八、 金融商品未實現損益：主係投資上市櫃公司股票及基金所產生之金融商品未實現損失增加所致。				
九、 庫藏股票：主係為維護公司信用及股東權益買回庫藏股份所致。				
(二)因應計畫：兩年度變動影響科目均對本公司財務狀況無重大影響。				



## 二、經營結果

### 1.經營結果比較分析：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	100 年度	99 年度	差異	
			金額	%
營業收入總額	1,269,683	1,160,167	109,516	9.44
減：銷貨退回及銷貨折讓	14,738	16,644	(1,906)	(11.45)
銷貨收入淨額	1,254,945	1,143,523	111,422	9.74
營業成本	996,274	910,585	85,689	9.41
營業毛利	258,671	232,938	25,733	11.05
營業費用	162,202	193,658	(31,456)	(16.24)
營業淨利	93,937	37,742	56,195	148.89
營業外收入	97,523	247,418	(149,895)	(60.58)
營業外支出	60,852	28,558	32,294	113.08
稅前淨利	130,608	256,602	(125,994)	(49.10)
所得稅利益	78,582	36,388	42,194	115.96
本期淨利	209,190	292,990	(83,800)	(28.60)

(一)最近二年度營業收入、營業利益及稅前純益重大變動之主要原因：

1. 銷貨退回及折讓增加：主係 99 年因驗收問題，部分客戶退回機台，故銷貨退回及折讓增加。
2. 營業毛利增加：主係本年度機台銷售較多，且銷售機台毛利較高所致。
3. 營業費用減少：主係 99 年度因庫藏股轉讓員工認列薪資費用及本年度估列之員工分紅及董監酬勞較 99 年減少所致。
4. 營業淨利增加：主係營業費用較上年度減少較多所致。
5. 營業外收入減少：主係本期認列轉投資事業獲利減少所致。
6. 營業外支出增加：主係應付公司債折價攤銷產生利息費用增加及應付公司債評價損失所致。
7. 所得稅利益增加：主係今年度迴轉較多部分估列以前年度之遞延所得稅負債，因而致所得稅利益增加。
8. 稅前及稅後淨利減少：主係因業外收益減少業外支出又增加所致。

(二)預期銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

隨近年來隨著智慧行動通訊興起，多媒體應用領域擴大，以及世界各國積極推動資訊化基礎建設並開發通信市場，帶動了全球行動裝置等資訊、通訊產品及其週邊產業蓬勃發展。而被動元件是電子產品中必要之關鍵零組件，隨著全球資訊及通訊市場規模持續擴大，預計對被動元件之需求量亦將持續增加。本公司 SMD 封裝材料出貨量將持續增加，加上 SMT 設備、鐳射設備及半導體設備等訂單挹注下，預計 101 年度毛利與獲利會較 100 年度成長。

### 三、現金流量

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	全年度來自 營業活動淨 現金流量	全年現金 流出量	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
367,341	103,113	(165,069)	305,385	—	—
<p>1. 100 年度現金流量變動情形分析：</p> <p>(1)營業活動之淨流入：主係因應收帳款收款天數縮減所致。</p> <p>(2)投資活動之淨流出：主係替關係人代墊款項及購買廠房，故產生淨現金流出。</p> <p>(3)融資活動之淨流出：主要發行轉換公司債而產生淨現金流入。</p> <p>2. 流動性不足之改善計畫：無。</p> <p>3. 未來一年現金流動性分析：</p> <p>本公司 101 年現金流出，主要係日常購料、進貨、支付薪資等營運支出，以及支付現金股利及償還借款等，因營收與收款狀況穩定，故能以營運資金與銀行借款支應。</p>					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：本公司最近年度並無重大資本支出。

五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫：

1. 轉投資政策：

- (1)於大陸市場布局，拓展海外生產據點，並就近服務客戶，提高產品市場佔有率。
- (2)以本業技術為核心，結合相關科技產業，增加產品之深度與廣度，並擴展客戶群，建立完整之設備產品供應鏈。
- (3)配合本公司從事能源事業開發，尋求新能源之相關業務整合機會，藉由集團運籌，已達相輔相成之效。

2. 轉投資獲利或虧損之主要原因：

100 年下半年起，全球景氣受歐債危機影響而逐步走緩，隨著電子產品終端需求下滑及原物料價格之上漲，本公司 SMD 封裝材料亦面臨中國大陸低價產品之削價競爭，故在營運規模無法大幅提升及生產成本增加之壓力下，相關經營 SMD 封裝材料之轉投資事業經營績效均不如預期，反觀從事 SMT 設備相關業務之轉投資事業則因受惠於電子大廠擴廠效應之設備訂單而績效顯著，致本公司於 100 年度仍認列投資收益 49,631 仟元。

3. 改善計畫：

100 年下半年起因歐債問題復燃，持續衝擊全球景氣，終端電子產品需求下滑，且相關原物料價格上漲，壓縮產品獲利，致 100 年度相關經營 SMD 封裝材料之轉投資事業營運不若預期。面對中國大陸市場低價產品充斥，該公司除積極尋求更具競爭力之合適料源外，亦致力於開發利基型產品，以改善大陸轉投資事業之營運及獲利能力。

#### 4. 未來一年投資計畫：

單位：新台幣仟元

計畫項目	實際或預期之 資金來源	實際或預期之 完成日期	所需資金總額	投資政策
長期股權投資- 興都科技股份有限公司	自有營運資金	101 年第二季	3,000	銷售代理日本與韓國 光電設備。
間接長期股權投資- 偉創興業股份有限公司	轉投資子公司之 自有營運資金	101 年第二季	3,000	銷售能源產品

## 六、風險事項分析評估

### (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣仟元

100 年度	長短期借款		匯率變動產生之 兌換利益
	利率	利息支出	
	1.18%~2.06%	8,799	19,590

- (1)本公司 100 年底長短期借款餘額為 639,912 仟元，利息支出為 8,799 仟元，占當年度營收比重約 0.70%，利率波動對公司損益影響尚屬有限。由於最近二年度國內中央銀行連續調高重貼現率，進而影響本公司向金融機構借款之利息支出，未來本公司將持續與各銀行保持密切聯繫，隨時注意利率走勢，尋求較低水準之籌資管道，以降低本公司之利息成本。
- (2)本公司 100 年度外銷比重佔銷售金額五成以上，兌換利益為 19,590 仟元，占當年度營業收入比重約 1.56%，匯率變動情形對公司損益尚屬有限。近年來匯率起伏不定，本公司為確保公司獲利，對於匯率走勢持續追蹤，並採取下列方式因應匯率之波動：
  - ①開立外幣帳戶，視資金之需求及匯率走勢，適度調節外匯部位。
  - ②於業務部銷售產品報價時考量因匯率變動連帶產生之售價調整，以保障應有之利潤，並以相同進貨幣別之外幣報價，以降低匯率風險。
  - ③每日蒐集匯率變動之相關資訊，充分掌握匯率走勢。
  - ④預購(預售)遠期外匯或其他衍生性金融商品。
- (3)最近年度通貨膨脹變動幅度並未顯著影響本公司營運，故對本公司之損益並無重大影響，本公司將隨時注意市場價格波動，避免通貨膨脹而對公司產生重大影響。

### (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

- (1)本公司財務操作以穩健為原則，並無從事高風險、高槓桿投資且各項投資案皆需經審慎評估後送至董事會表決通過。最近年度及截至年報刊印日止本公司並未從事有關高風險、高槓桿投資。
- (2)最近年度及截至公開說明書刊印日止本公司資金貸與他人及背書

保證對象僅限於子公司之資金融通需求，且不得逾越主管機關法令及本公司內部規定之條件或限額，本公司截至目前止除子公司外，對外未有背書保證或資金貸與他人之情形，且均依本公司訂定之處理程序規定辦理，並同時依法辦理公告申報，並無重大不利之影響。

- (3) 本公司從事衍生性商品交易均依「取得或處分資產處理程序」規定辦理，並依法令規定辦理公告申報。另本公司買賣遠期外匯合約及從事衍生性金融商品交易係為規避外幣債權債務之匯率變動風險，未來仍採自然平衡政策。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

1. 未來計畫開發產品項目：

產品名稱	內容
Uv微盲孔鑽孔機	因應多層軟性電路板高密度內部微連結製程的需要，在銅箔上需要精密的微盲孔或穿孔的快速加工方案，此技術目前只有美國廠商ESI單一廠商能夠做到，因此我部門開始進行研發更高效率的新款機型。
IR鐳射焊接機	現今的智慧手機為提高更好的品質，會在原PCB板上再焊上一個鐵製遮蔽盒，目的在保護內部元件不受外界干擾，能更順暢的運作，焊接鐵盒必須仰賴人工操作，開始著手研發自動化鐳射焊接機來取代人工作業，目前實驗階段已接近完成。
IR鐳射除圍膠機	BGA返修過程，摘除BGA時的人工作業，非常容易導致報廢，藉此研發雷射除圍膠機，用鐳射非接觸式的方式先將固定膠劃出一道深溝，如此摘除BGA，可減少報廢率更可提高產能，目前相關部件已進入採購階段。
Green鐳射電感鑽孔機	將green鐳射導入0201電感鑽孔製程，目前已完成實驗階段，待軟硬體整合後即可完成。
Ball Screw劃線機	開發滾珠螺桿劃線機，將可提升劃線速度20%，目前已完成硬體結構，要提升至最高速的極限，軟體仍待測試。
雷射頻率修整機	精密雷射頻率修整機，以修整石英振盪器頻率為主。
Robot 機械臂	導入三軸 robot 機械臂取代傳統流道應用。
多頭鐳射應用	研發雙頭，四頭(多頭)劃線機、切割機、鑽孔機、雕刻機，提高產能效率。
手持式二維雕刻機	現今的所有成品或半成品都已漸漸開始注重產品的身份證明，2D barcode 已趨於普及，由上游到下游都必須進行身份的驗證，預計研發輕巧的手持式二維雕刻機，運用層面可廣及所有產業。

2. 預計再投入之研發費用：

本公司未來將持續投入產品研發，提高市場競爭力，預估101年度總研發經費約25,000仟元。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

因應主管機關針對公司治理、公司法、證交法及IFRSs等重要政策及相關法律之修訂，本公司均配合之；此外，本公司管理階層隨時觀察注意國內外重要政策及法律變動，並適時主動提出因應措施，故對本公司財務業務尚無重大影響。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時注意所處行業相關科技改變之情形，並視情況指派專人或專案小組評估研究對於公司未來發展及財務業務之影響性暨因應措施，最近年度並無重要科技改變或產業變化致對本公司財務業務有重大影響之情事。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司向來重視企業形象，截至年報刊印日止並未發生足以影響企業形象之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司並無進行中之併購案，亦無因此產生之效益、風險及因應措施。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司截至公開說明書刊印日止並無擴充廠房計畫。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

進貨方面：本公司主要從事主被動元件之包裝材料、鐳射設備及SMT相關設備之製造與銷售，各項業務皆有數家供應商供貨。最近年度並無單一供應商進貨淨額超過當年度進貨淨額之30%，且進貨來源日趨分散，尚無進貨過度集中之風險。

銷貨方面：本公司100年度前十大銷貨客戶占該年度營業收入淨額均未超過30%，銷貨對象尚屬分散，並無過度集中之風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近三年度及截至公開說明書刊印日止，董事、監察人（本公司無持股超過10%以上之大股東）股權移轉情形變化不大，對公司影響尚屬有限。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司 99 年 6 月 4 日董監任期屆滿全面改選，改選後七席董事有二席發生變動，董事變動未達三分之一以上，故無經營權改變之情形發生。

(十二) 訴訟或非訴訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

1. 本公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟：

本公司目前尚在繫屬中之訴訟共計兩件，訴訟金額皆不大，其結果對本公司股東權益或證券價格並無重大影響。

2. 本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東及從屬公司，已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訴訟或行政訴訟事件，其結果可能對公司營運或股東權益有重大影響者：

本公司一名監察人目前有一件尚在繫屬中之訴訟，其結果對本公司股東權益或證券價格並無重大影響。

3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

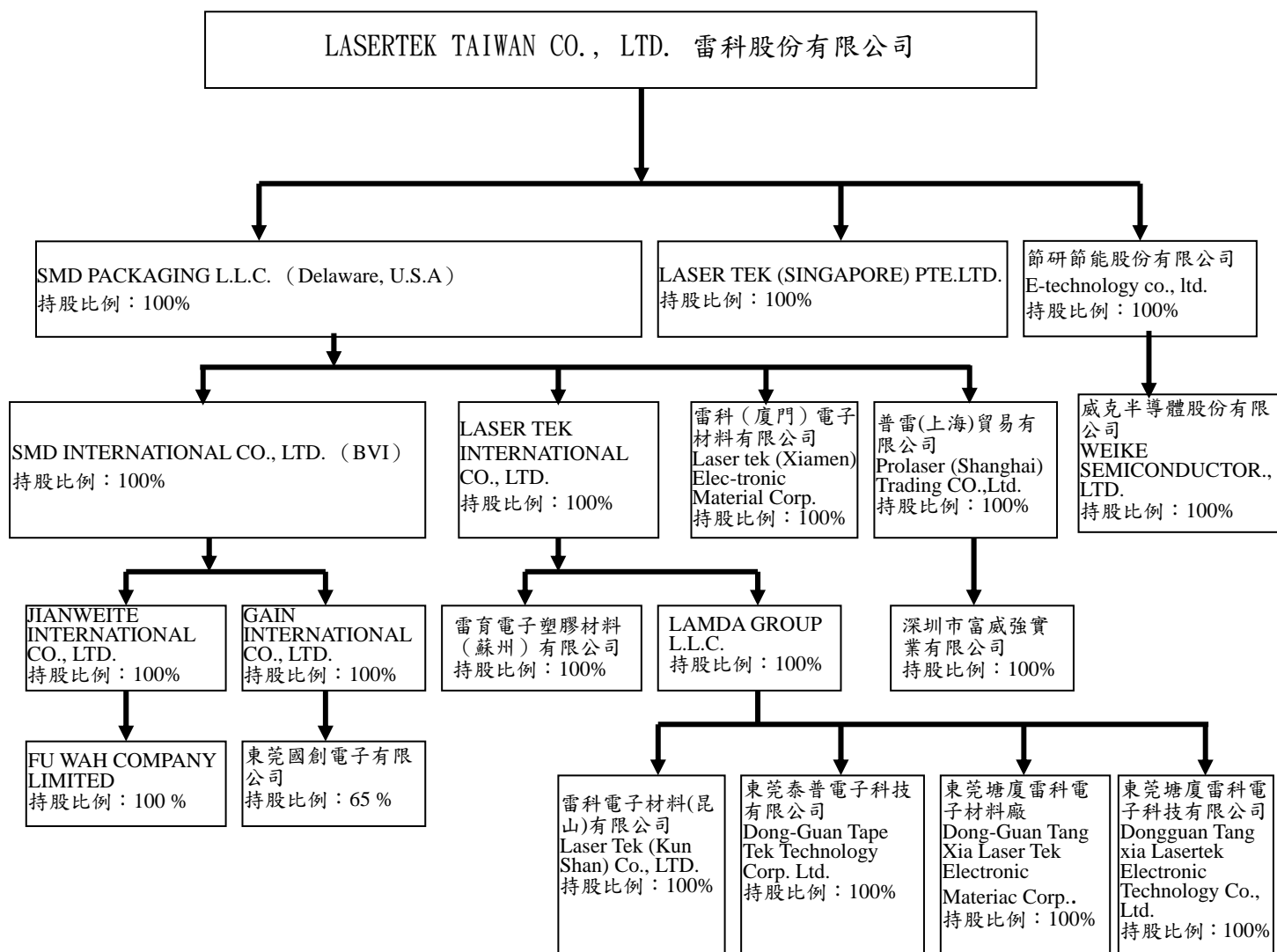
(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

## 捌、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

#### (一)關係企業圖



(二)各關係企業基本資料

企業名稱	實收資本額	主要營業或生產項目
SMD PACKAGING L. L. C.	USD10,678,065	控股公司
LASER TEK(SINGAPORE) PTE. LTD.	SGD3,820,000	1. FDR資訊擷取系統 2. LCD TEST 3. 電子測試治具 4. 鐳射調阻機
節研節能股份有限公司	NTD40,000,000	照明設備安裝工程業、電器與電子材料批發業及國際貿易業
威克半導體股份有限公司	NTD26,000,000	電器與電子材料零售、批發業、半導體設備及零件
SMD INTERNATIONAL CO., LTD.	USD3,970,000	晶片電阻封裝紙帶及防靜電配方之上下膠帶分條加工及 出售
LASER TEK INTERNATIONAL CO., LTD.	USD1,905,734	晶片電阻封裝紙帶及防靜電配方之上下膠帶分條加工及 出售
普雷(上海)貿易有限公司	USD200,000	國際貿易、轉口貿易、保稅區內企業間的貿易及貿易代理
雷科(廈門)電子材料有限公司	RMB2,600,000	紙帶、上下膠帶之產銷業務
JIANWEITE INTERNATIONAL CO., LTD.	USD1,320,474	主要從事SMT設備代理銷售、設備維修服務、備品銷售、SMT前端材料代理銷售等業務。
GAIN INTERNATIONAL CO., LTD.	USD920,000	控股公司
雷育電子塑膠材料(蘇州)有限公司	USD1,666,000	生產塑膠產品、電子元器件包裝材料、設計、生產、組裝自動化設備
LAMDA GROUP L. L. C.	USD3,704,000	晶片電阻封裝紙帶及防靜電配方之上下膠帶分條加工。
深圳市富威強實業有限公司	RMB1,010,000	主要從事 SMT 設備代理銷售、設備維修服務、備品銷售、SMT 前端材料代理銷售等業務
FU WAH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	USD785,146	主要從事 SMT 設備代理銷售、設備維修服務、備品銷售、SMT 前端材料代理銷售等業務
東莞國創電子有限公司	RMB14,043,260	被動元件之產銷
雷科電子材料(昆山)有限公司	USD1,992,000	晶片電阻封裝紙帶分條加工。
東莞泰普科技有限公司	USD1,037,000	生產與銷售元器件實用材料。
東莞塘廈雷科電子科技有限公司(註)	USD750,000	生產和銷售晶片封裝膠帶、晶片封裝紙帶。

註：於 100 年 12 月開始投資。

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無



(四)各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：新台幣、美金、人民幣仟元/仟股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			投資金額	持股比例
SMD PACKAGING L. L. C.	董事長	雷科股份有限公司 鄭再興(代表人)	348,213	100%
LASER TEK(SINGAPORE) PTE.LTD.	董事長	雷科股份有限公司 鄭再興(代表人)	80,458	100%
節研節能股份有限公司	董事長	雷科股份有限公司 鄭再興	40,000	100%
威克半導體股份有限公司	董事長	節研節能股份有限公司 黃郁婷	25,060	100%
SMD INTERNATIONAL CO., LTD.	代表人	SMD PACKAGING L. L. C 鄭再興(代表人)	USD3,970	100%
LASER TEK INTERNATIONAL CO., LTD.	代表人	SMD PACKAGING L. L. C 鄭再興(代表人)	USD1,905	100%
普雷(上海)貿易有限公司	代表人	鄭玉慧(代表人)	USD200	100%
雷科(廈門)電子材料有限公司	代表人	鄭玉慧(代表人)	USD314,000	100%
JIANWEITE INTERNATIONAL CO., LTD.		SMD INTERNATIONAL CO., LTD. 鄭再興(代表人)	USD6,596	100%
GAIN INTERNATIONAL CO.,LTD.	代表人	SMD INTERNATIONAL CO., LTD. 鄭再興(代表人)	USD920	100%
雷育電子塑膠材料(蘇州)有限公司	代表人	鄭玉慧(代表人)	USD1,666	100%
LAMDA GROUP L. L. C.	代表人	LASER TEK INTERNATIONAL CO., LTD. 鄭再興(代表人)	USD3,704	100%
深圳市富威強實業有限公司	代表人	鄭玉慧(代表人)	RMB1,010	100%
FU WAH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	代表人	SMD INTERNATIONAL CO., LTD. 鄭再興(代表人)	USD785	100%
東莞國創電子有限公司	代表人	鄭玉慧(代表人)	USD920	65%
雷科電子材料(昆山)有限公司	代表人	鄭玉慧(代表人)	USD1,692	100%
東莞泰普科技有限公司	代表人	鄭玉慧(代表人)	USD987	100%
東莞塘廈雷科電子科技有限公司(註)	代表人	鄭玉慧(代表人)	USD750	100%

註：於100年12月開始投資。

(五)各關係企業營運狀況

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘(元) (稅後)
SMD PACKAGING L. L. C.	348,213	1,450,522	76	1,450,446	0	(119)	61,930	—
LASER TEK(SINGAPORE) PTE.LTD.	80,458	177,417	94,723	82,694	82,694	(12,213)	(8,092)	—
節研節能股份有限公司	40,000	43,624	2,326	41,298	455	(4,499)	(4,895)	—
威克半導體股份有限公司	26,000	167,287	133,396	33,891	93,930	(1,027)	(153)	—
SMD INTERNATIONAL CO., LTD.	120,132	830,509	239,270	591,239	359,355	26,850	77,391	—
LASER TEK INTERNATIONAL CO., LTD.	57,668	787,911	51,728	736,183	555,391	(25,601)	(14,101)	—
普雷(上海)貿易有限公司	7,939	78,690	34,116	44,574	79,356	(757)	1,671	—
雷科(廈門)電子材料有限公司	12,470	13,943	(59)	14,002	0	(107)	(78)	—
JIANWEITE INTERNATIONAL CO., LTD.	199,595	244,417	144,626	99,791	131,206	22,357	59,249	—
GAIN INTERNATIONAL CO.,LTD.	27,839	70,828	136	70,692	0	(110)	218	—
雷育電子塑膠(蘇州)有限公司	53,392	49,321	0	49,321	0	(4,072)	(4,072)	—
LAMDA GROUP L. L. C.	131,151	119,407	14,335	105,172	0	(592)	(10,278)	—
深圳市富威強實業有限公司	4,844	44,203	34,656	9,547	11,904	(89)	(78)	—
FU WAH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	23,759	167,771	103,180	64,591	219,004	41,318	40,247	—
東莞國創電子有限公司	67,351	207,776	99,397	108,379	293,883	(1,522)	481	—
雷科電子材料(昆山)有限公司	63,517	50,319	6,558	43,761	40,222	(9,099)	(13,116)	—
東莞泰普科技有限公司	38,518	105,284	69,690	35,594	108,264	(7,765)	(7,516)	—
東莞塘廈雷科電子科技有限公司	22,664	23,006	470	22,536	0	(126)	(128)	—

雷科股份有限公司

董事長：鄭再興